การประดิษฐ์นาโนโฮลจาก In_{o.15}Ga_{o.85}As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs ด้วยวิธีดรอปเพลทอิพิแทกซีที่ใช้การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุล

Fabrication of In_{0.15}Ga_{0.85}As nanoholes on GaAs substrates formed by droplet epitaxy using molecular beam epitaxy

โดย

สมชัย รัตนธรรมพันธ์ D. Eng. (Chulalongkorn Univ.)

โครงการวิจัยเลขที่ 108G-EE-2552 ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

กันยายน 2554

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปังบประมาณ 2552 นอกจากนี้โครงการนี้ยัง ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช) โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) Asian office of Aerospace Research and Development (AOARD) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยขอขอบ พระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญแก้ว ที่ได้ให้การสนับสนุนและคำแนะนำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อ โครงงานวิจัยนี้ พร้อมทั้งคุณศุภโชค ไทยน้อย คุณขวัญเรือน ไทยน้อย คุณพรชัย ช่างม่วง ดร.วิภากร จีวะสุวรรณ ดร. ปุณยศิริ บุญเป็ง ดร.นราพร ปั้นเก่าและคุณองอาจ ตั้งเมตตาจิตตคุล ที่ให้ความช่วยเหลือ ในการวิจัยนี้

ชื่อโครงการวิจัยการประดิษฐ์นาโนโฮลจาก In _{o.15} Ga _{o.85} As บนแผ่นผลึกฐาน.GaAs
ด้วยวิธีครอปเพลทอิพิแทกซีที่ใช้การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุล
ชื่อผู้วิจัยสมชัยรัตนธรรมพันธ์
ดือนและปีที่ทำวิจัยเสร็จ กันยายน 2554

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ทำได้การศึกษาการประดิษฐ์โครงสร้างนาโนโฮล In_{o.15}Ga_{o.85}As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs (100) ด้วยเทคนิคครอปเพลทอิพิแทกซีที่ใช้การปลูกผลึกอิพิแทกซีกจากลำ โมเลกุล ซึ่งใน โครงการวิจัยนี้ทำ การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการประคิษฐ์ อันได้แก่ ค่าอุณหภูมิแผ่น ้ผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุคโลหะ ค่าช่วงเวลาการขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุคโลหะ ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึก ฐานขณะทำการคริสตอลไลเซชัน และค่าช่วงเวลาในการคริสตอลไลเซชัน สำหรับค่าอุณหภูมิแผ่นผลึก ฐานขณะขึ้นรูปหยุดโลหะที่ใช้ในการทดลองอยู่ในช่วง 270-360°C ค่าช่วงเวลาการขัดจังหวะหลังการขึ้น รูปหยุดโลหะอยู่ในช่วง 0-10 นาที ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำคริสตอลไลเซชันอยู่ในช่วง 170-260°C และค่าช่วงเวลาในการทำคริสตอล ใลเซชันอยู่ในช่วง 1-10 นาที่ โดยตัวอย่างที่ได้ในงานวิจัยนี้ถูก วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) ซึ่งค่าความหนาแน่นของโครงสร้างขนาคนาโนเมตรที่ ใด้อยู่ในช่วง 6×10⁸ -1.8 ×10⁹ ซม² ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของสันขอบวงแหวนอยู่ในช่วง 90-120 nm และค่าเฉลี่ยความลึกของนาโนโฮลอยู่ในช่วง 2-5 nm โดยขึ้นกับเงื่อนไขที่ใช้ในกระบวนการประคิษฐ์ สำหรับอิทธิพลของอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุคโลหะมีผลต่อค่าความหนาแน่นและค่าขนาคมิดิ ของนาโนโฮล ค่าความหนาแน่นมีค่าลคลงและค่าขนาดมิติมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้น รูปหยุดโลหะมีค่าสูงขึ้น สำหรับอิทธิพลของค่าช่วงเวลาการขัดจังหวะภายหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะนั้นมี ผลต่อค่าความหนาแน่นของนาโนโฮลอย่างเค่นชัค และอิทธิพลของอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการ คริสตอล ใลเซชันมีผลต่อรูปร่างของ โครงสร้างขนาดนาโนเมตร คือ เมื่ออุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการ คริสตอล ใลเซชันมีค่าต่ำกว่า 230°C จะได้โครงสร้างนาโน โฮล แต่เมื่ออุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการ คริสตอลไลเซชันตั้งแต่ 230°C เป็นต้นไปจะได้โครงสร้างควอนตัมคอตที่ล้อมรอบด้วยวงแหวนนาโนหรือ นาโนริงค์ นอกจากนี้ได้มีการสาธิตการนำโครงสร้างนาโนโฮลมาประยุกต์ใช้เป็นเทมเพลในการประคิษฐ์ โกรงสร้างกวอนตัมคอตโมเลกุลที่เรียงตัวค้านข้างได้สำเร็จ แต่จำนวนควอนตัมคอตในกวอนตัมคอต โมเลกุลมีค่า 2 คอต 3 คอตและ 4 คอต

Project Title Fabrication of In _{0.15} Ga _{0.85} As nanoholes on GaAs substrates formed by droplet epitaxy
using molecular beam epitaxy
Name of InvestigatorSomchai RATANATHAMMAPHAN
YearSeptember 2011

Abstract

This work reports on the fabrication of self-assembled $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ nanoholes on GaAs (100) by droplet epitaxy using molecular beam epitaxy. The effect of growth parameters such as substrate temperature during droplet forming, interruption time after droplet forming, crystallization temperature, and crystallization time were investigated. The surface morphology of $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ nanoholes were examined by atomic force microscope (AFM). The results showed the dependence of density, depth, and width of nanoholes on the growth parameters. The growth parameters were 270-360°C for the substrate temperature, 0-10 minutes for the interruption time, 170-260°C for the crystallization temperature, and 1-10 minutes for the crystallization time. The density were in range of 6×10^8 -1.8 $\times 10^9$ cm⁻² which decreased while increasing the substrate temperature. The structural were the depth in range of 2-5 nm, and the outer diameter in range of 90-120 nm along [110]. The crystallization temperature affected on the final shape of nanostructure. The crystallization temperature below 230°C, the nanostructure was nanohole. But the temperature higher than 230°C, the nanostructures were nanohole and quantum-dot surrounded with nanoring. An application of the fabrication of InAs lateral quantum-dot molecules on $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ nanohole template was also demonstrated in this work. The lateral quantum-dot molecules are bi-quantum-dot, tri-quantum-dot, and quadra-quantum-dot molecules.

สารบัญ

กิตติกรร	รมประกาศ	II
บทคัดข่ะ	อภาษาไทย	
บทคัดข่ะ	อภาษาอังกฤษ	IV
สารบัญ.		V
สารบัญด	ตาราง	VII
สารบัญรู	รูป	VII
สารบัญส	สัญญูลักษณ์	X
บทที่ เ	บทนำ	1
	1.1 บทน้ำ	1
	1.2 วัตถุประสงค์	2
	1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย	3
	1.4 สาระของรายงานวิจัย	3
บทที่ 2	ความรู้พื้นฐาน	4
	2.1 การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำ โมเลกุล	4
	2.1.1 ชุคระบบการปลูกผลึกอิพิแทกซึ่งากลำโมเลกุล	5
	2.1.2 Effusion cell	6
	2.1.2.1 Knudsen cell	
	2.1.2.2 Cracker cell	9
	2,1.2.3 Valved cracker cell	10
	2.1.2.4 Gas injection cell	11
	2.1.3 อุปกรณ์วิเคราะห์	12
	2.1.3.1 Reflection high energy diffraction electron (RHEED)	13
	2.1.3.2 Residual gas analyzer	15
	2.1.3.3 อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถติดตั้งเข้าในระบบ MBE	15
	2.2 กลไกการเกิดผลึกของการปลูกผลึกอิพิแทกซีวิธี MBE	16
	2.3 เทคนิคการปลูกผลึกครอปเพลทอิพิแทกซี	19
	2.4 สารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-∨	21
	2.4.1 โครงสร้างของสารประกอบกิ่วตัวนำกลุ่ม III-V	

สารบัญ (ต่อ)

	2.4.2 คุณสมบัติของสารประกอบกิวตัวน้ำกลุ่ม III-V
บทที่ 3	การออกแบบการทคลอง24
	3.1 การเตรียมตัวอย่าง
	3.2 การศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการประดิษฐ์โครงสร้างนาโนโฮถ In _{0.15} Ga _{0.85} As
	3.2.1 การทคลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุคโลหะ2
	3.2.2 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการรูปหยุคโลหะ25
	3.2.3 การทคลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่นในการทำคริสตอลไลเซชัน25
	3.2.4 การทคลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการทำคริสตอลไลเซชัน25
	3.3 การวิเคราะห์ตัวอย่าง
บทที่ 4	ผลการทคลองและการวิเคราะห์
	4.1 การทคลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุคโลหะ23
	4.2 การทคลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุคโลหะ
	4.3 การทคลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิในการคริสตอลไลเซชัน
	4.4 การทคลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าเวลาในการคริสตอล ไลเซชัน
บทที่ 5	ตัวอย่างการประยุกต์
	5.1 วิธีการประดิษฐ์
	5.2 ผลการทคลองและการวิเคราะห์
บทที่ 6	สรุป
บทที่ 7	ข้อเสนอแนะ
อกสารอ้า	งอิ่ง41
เลงานการ	เผยแพร่ของงานวิจัยนี้

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1	ตารางเปรียบเทียบชนิคของ Effusion cell และชนิคของลำโมเลกุลที่ได้	
	จากวัตถุคิบชนิคต่างๆ	12
ตารางที่ 2.2	รายการส่วนประกอบพื้นฐานใน Growth chamber ของระบบ MBE	16
ตารางที่ 2.3	อุณหภูมิจุคระเหิดของสารประกอบ III-V ชนิคต่างๆ	
ตารางที่ 2.4	ตัวแปรทางกายภาพของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ชนิค 2 ธาตุ	
ตารางที่ 2.5	ค่าแถบพลังงานของตัวอย่างสารประกอบชนิค 3 ธาตุและ 4 ธาตุ	23
ตารางที่ 4.1	สรุปผลการทคลองการศึกษาอิทธิพลของก่าอุณหภูมิในการคริสตอลไลเซชัน	
	ในเทอมของตัวแปรขนาคจากนาโนโฮลที่ได้	
ตารางที่ 4.2	สรุปผลการทคลองการศึกษาอิทธิพลของค่าเวลาในการคริสตอลไลเซชัน	
	ในเทอมของตัวแปรขนาคจากนาโนโฮลที่ได้	

สารบัญรูป

รูปที่ 2.1	ภาพโครงสร้างชุดระบบ MBE ของ RIBER รุ่น 32 P6
รูปที่ 2.2	แผนภาพโครงสร้าง Knudsen cell
รูปที่ 2.3	ภาพโครงสร้างของ Ga-trapping cap9
รูปที่ 2.4	ภาพโครงสร้างของ Cracker cell10
รูปที่ 2.5	ภาพของ Arsenic valve cracker cell
รูปที่ 2.6	ภาพโครงสร้างของ Effusion cell ชนิด Gas injector cell12
รูปที่ 2.7	แผนภาพอธิบายกล ใกการเปลี่ยนแปลงความเข้มของอิเล็กตรอน ในขณะทำการปลูกผลึก14
รูปที่ 2.8	แผนภาพความสัมพันธ์ของรูปแบบ RHEED และอุณหภูมิของแผ่นผลึกฐาน
	(100) GaAs, InP และ InAs ภายใต้ใอของ Dimer14
รูปที่ 2.9	แบบจำลองปฏิกิริยาของการเกิคผลึก GaAs ในกรณี Ga-As ₂ -(100) GaAs
รูปที่ 2.10	แบบจำลองปฏิกิริยาของการเกิคผลึก GaAs ในกรณี Ga-As₄-(100) GaAs
รูปที่ 2.11	แบบจำลองการแพร่ของ As ในหยุคโลหะ Ga (ก) และการเกิดผลึกในหยุคโลหะ Ga
	ภายใต้ไอของ As (ข) ในกระบวนการคริสตอลไลเซชัน
รูปที่ 2.12	แผนภาพโครงสร้างแบบ Zinceblende21
รูปที่ 4.1	(ก) ภาพ AFM ของนาโนโฮลจาก In _{0.15} Ga _{0.85} As บน GaAs
	(ข) ภาคตัคขวางของตัวอย่างในกรอบเส้นประจากรูป (ก)
รูปที่ 4.2	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นของนาโนโฮล (ก) และค่าเฉลี่ยความกว้าง
	ระหว่างสันขอบวงแหวน (ข) ในฟังก์ชันของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุคโลหะ28
รูปที่ 4.3	ฮีสโตแกรมการกระจายค่าความลึกของนาโนโฮลจากตัวอย่างที่มีค่าช่วงเวลาขัดจังหวะหลัง
	การขึ้นรูปหยุดโลหะ (ก) 0 นาที (ข) 2 นาที (ค) 5 นาที และ (ง) 7 นาที
รูปที่ 4.4	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นของนาโนโฮล (ก) แลค่าเฉลี่ยความกว้าง
	ในแนว [110] (ข) ในฟังก์ชันของค่าช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะ43
รูปที่ 4.5	ภาพ AFM ของนาโนโฮลจาก In _{o.15} Ga _{o.85} As บน GaAs จากตัวอย่างที่ทำการครีสตอลไลเซชัน
	ที่อุณหภูมิ (ก) 200 °C (ข) 260°C
รูปที่ 4.6	ภาพภาคตัดขวางผ่าน AFM ของนาโนโฮลจาก In _{o.15} Ga _{o.85} As บน GaAs
	จากตัวอย่างที่ทำการคริสตอลไลเซชันที่อุณหภูมิ (ก) 200 °C (ข) 260°C

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 5.1	ภาพ AFM แบบ 2 มิติ 3 มิติ และภาพภาคตัดขวางของ (ก) นาโนโฮล (ข) นาโนที่เปลี่ยนรูปไป
	หลังการเพิ่มอุณหภูมิ และ (ก) ควอนตัมคอต โมเลกุลชนิค 4 คอต
รูปที่ 5.2	ภาพ AFM แบบ 3 มิติของควอนตัมคอต โมเลกุลชนิด (ก) 2 คอต (ข) 3 คอต และ (ก) 4 คอต 36
รูปที่ 5.3	กราฟแสดงการกระจายของจำนวนประชากรของควอนตัมคอต โมเลกุลที่มีจำนวน 2 คอต
	3 ดอต และ 4 ดอตในแต่ละ โมเลกุล

สารบัญสัญญลักษณ์

AFM	Atomic Force Microscope
AlAs	: Aluminium Arsenide
AlP	: Aluminium Phosphide
AlSb	: Aluminium Antimonide
AlInAs	: Aluminium Indium Aresenide
AlGaInAs	: Aluminium Gallium Indium Arsenide
As	Arsenic
E_{g}	Bandgap Energy
GaAs	: Gallium Arsenide
GaP	: Gallium Phosphide
GaSb	: Gallium Antimonide
GaInAsP	: Gallium Indium Arsenide Phosphide
InAs	: Indium Arsenide
InP	: Indium Phosphide
InSb	: Indium Antimonide
MBE	: Molecular Beam Epitaxy
MOCVD	: Metal-Organic Chemical Vapor Deposition
Р	Phosphorus
QMS	Quadupole Mass Spectrometer
RHEED	: Reflection High Energy Electron Diffraction
Sb	Antimony
SIMS	Secondary Ion Microscopic Spectroscopy
UHV	: Ultra-high vacuum

1.1 บทน้ำ

โครงสร้างขนาคนาโนเมตร (Nanostructure) ของสารกึ่งตัวนำได้เป็นที่คึงดูดใจของนักวิจัยและ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ด้วยสาเหตุจากคุณสมบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) เชิงแสง (Optical) เชิง แม่เหล็ก (Magnetics) และเชิงแม่เหล็ก-แสง (Magnetro-optic) ของโครงสร้างขนาดนาโนเมตรที่มีความ พิเศษแตกต่างๆ ไปโครงสร้างแบบมวลสารปกติ เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษที่มีสามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างโครงสร้างขนาคนาโนเมตร ได้แก่ จากโครงสร้างควอนตัมคอต (Quantum dot) ควอนตัมไวร์ (Quantum wire) และควอนตัมริงค์ (Quantum ring) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างขนาคนาโนเมตรแบบซับซ้อน (Complex Nanostructure) ตัวอย่าง เช่น โครงสร้างควอนตัมดอต โมเลกุล (Quantum-dot molecule) และ โครงสร้างนาโนโฮล (Nanohole) ที่มี คุณสมบัติพิเศษกว่าโครงสร้างขนาคนาโนเมตรแบบปกติทั่วไปคือความเหมาะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ งานในด้าน Quantum computing [1] และ Quantum cryptography [2] โดยโครงสร้างดังกล่าวมีข้อกำหนดที่ เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานเหล่านั้นคือมีค่าความหนาแน่นต่ำ เพื่อให้การเข้าถึงตำแหน่งของ โครงสร้างขนาดนาโนเมตรสามารถทำได้ง่ายและแม่นยำ รวมถึงคุณสมบัติการกักพาหะ (Carrier confinement) สำหรับวิธีการประคิษฐ์โครงสร้างขนาดนาโนเมตรในขุดคั้งเดิมนั้นเริ่มต้นจากการประดิษฐ์ โครงสร้างกวอนตัมเวลล์ (Quantum well) และทำการขึ้นรูปขนาคนาโนด้วยกระบวนการลิโทกราฟ (Lithograph) และการกัดขึ้นรูปทางเคมี (Chemical etching) ซึ่งวิธีการนี้มีขีดจำกัดหลายประการคือไม่ เหมาะสมสำหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ โกรงสร้างที่ได้นั้นมีจุดบกพร่อง (Defect) และการปนเปื้อน (Contamination) ภายใน โครงสร้างภายหลังกระบวนการกัดขึ้นรูปทางเคมี สำหรับอีกวิธีการหนึ่งคือ การปลูกผลึกโครงสร้างขนาดนาโนเมตรในแบบการก่อตัวขึ้นเอง (Self Assembly) ที่มีชื่อเรียกว่า Stranski-Krastanov (SK) growth mode หรือการปลูกผลึกในแบบ SK [3] ซึ่งคุณภาพผลึกที่ได้มีความ สมบูรณ์และมีคุณสมบัติที่ดี แต่อย่างไรก็ดีกลไกการปลูกผลึกในแบบ SK นี้ผลึกที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็น แบบ Random ทำให้ควอนตัมดอตที่ได้นั้นไม่มีการเรียงตัวหรือการก่อตัวขึ้นรูปเป็นควอนตัมดอตโมเลกุล รวมทั้งไม่สามารถกำหนดตำแหน่งการเกิดได้ ซึ่งวิธีการที่ทำให้เกิดการเรียงตัวเป็นควอนตัมคอตโมเลกุล ้ คือการใช้นาโนโฮลเป็นเทมเพลท (Template) ในการขึ้นรูป โดยวิธีการประดิษฐ์นาโนโฮลได้มีการเริ่มต้น จากการประคิษฐ์ด้วยการกัดขึ้นรูปทางเคมีจากโครงสร้างควอนตัมดอตที่มีการปลูกกลบ (Capping regrowth) ด้วยชั้นผลึกบางๆ แต่ด้วยปัญหาของโครงสร้างที่ได้นั้นมีจุดบกพร่อง (Defect) และการปนเปื้อน (Contamination)ภายในโครงสร้างภายหลังกระบวนการกัดขึ้นรูปทางเคมี [4] สำหรับอีกวิธีการหนึ่งใน การประดิษฐ์โครงสร้างขนาคนาโนเมตรด้วยวิธี Droplet epitaxy ตัวอย่างของการใช้วิธีการนี้ ได้แก่ การ ประคิษฐ์ Nanoscale mound-like template [5] ซึ่งได้มีการศึกษาและสามารถประคิษฐ์โครงสร้างควอนตัม คอตโมเลกุลได้

ดังนั้นกระบวนการประดิษฐ์โครงสร้างขนาดนาโนเมตรที่เป็นนาโนโฮลและควอนตัมดอตโมเลกุล ที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยการเริ่มด้นการประดิษฐ์ด้วยวิธี Droplet epitaxy [6] อันเป็น กุญแจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี Quantum Computing และ Quantum cryptography ที่อาศัยโครงสร้าง นาโนโฮลเป็นเทมเพลทในการขึ้นรูปดวอนตัมดอทโมเลกุล และเทคนิกการประดิษฐ์นี้มีศักยภาพในการ ประดิษฐ์โครงสร้างดังกล่าว โดยกระบวนการของเทคนิดดังกล่าวสำหรับสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V เริ่มต้นด้วยการขึ้นรูปหยดโลหะ (Droplet) ของธาตุหมู่ III จากนั้นทำการเปลี่ยนรูปหยดโลหะให้กลายเป็น สารประกอบ III-V ด้วยไอของธาตุหมู่ V โดยกระบวนการนี้เราเรียกว่า กริสตอลไลเซชัน (Crystallization) ซึ่งกลไกการเปลี่ยนรูปร่างของหยดโลหะนี้ขึ้นกับเงื่อนใขในกระบวนการขึ้นรูปหยดโลหะให้กลายเป็น สารประกอบ III-V ด้วยไอของธาตุหมู่ V โดยกระบวนการนี้เราเรียกว่า กริสตอลไลเซชัน (Crystallization) ซึ่งกลไกการเปลี่ยนรูปร่างของหยดโลหะนี้ขึ้นกับเงื่อนใขในกระบวนการขึ้นรูปหยดโลหะในกระบวนการ ประดิษฐ์ ซึ่งปัจจุบันมีหลายสถาบันกำลังทำการวิจัยให้การประดิษฐ์โครงสร้างนาโนโฮลและควอนตัมดอท โมเลกุลด้วยวิธีครอปเพลทอิพิแทกซี (Droplet Epitaxy) ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมทางด้านองก์กวามรู้ (Knowhow) สำหรับรองรับการพัฒนาด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ดำริโครงงานวิจัยนี้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาเทกนี้คการปลูกผลึก Droplet epitaxy ที่ใช้วิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุล (Molecular beam epitaxy : MBE) ในการประดิษฐ์โครงสร้างนาโนโฮลจากสารประกอบ In_{o.15}Ga_{o.85}As บน แผ่นผลึกฐาน GaAs (100)

1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าตัวแปรที่ใช้ในเทคนิคการปลูกผลึก Droplet epitaxy ที่ใช้วิธีการ ปลูกผลึกอิพิแทกจากลำโมเลกุล ได้แก่ ค่าความหนาหรือปริมาณของโลหะในกระบวนการขึ้นรูปหยดโลหะ ค่าอุณหภูมิขณะขึ้นรูปหยดโลหะ ช่วงเวลาหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ ค่าอุณหภูมิและช่วงเวลาในการคริส ตอลไลเซชันที่มีต่อรูปร่างของโครงสร้างนาโนโฮลจากสารประกอบ In_{0.15}Ga_{0.85}As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs (100)

 1.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์โครงสร้างควอนตัมดอตโมเลกุลด้วยการใช้เทม เพลท (Template) ของโครงสร้างนาโนโฮลจากสารประกอบ In_{0.15}Ga_{0.85}As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs (100)

1.3 ขอบเขตของโครงงานวิจัย

3.1 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าตัวแปรที่ใช้ในเทคนิคการปลูกผลึก Droplet epitaxy ที่ ใช้วิธีการปลูกผลึกอิพิแทกจากลำโมเลกุล ได้แก่ ค่าความหนาหรือปริมาณของโลหะในกระบวนการขึ้น รูปหยุคโลหะ ค่าอุณหภูมิขณะขึ้นรูปหยุคโลหะ ช่วงเวลาหลังการขึ้นรูปหยุคโลหะ ค่าอุณหภูมิและช่วงเวลา ในการคริสตอลไลเซชันที่มีต่อรูปร่างของโครงสร้างนาโนโฮลจากสารประกอบ In_{o.15}Ga_{o.85}As บนแผ่นผลึก ฐาน GaAs (100)

3.2 การทคลองเพื่อสาธิตการประคิษฐ์โครงสร้างควอนตัมคอตโมเลกุลด้วยการใช้เทมเพลทของ โครงสร้างนาโนโฮลจากสารประกอบ In_{0.15}Ga_{0.85}As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs (100)

1.4 สาระของรายงานวิจัย

สำหรับรายงานวิจัยนี้มีเนื้อหาสาระดังนี้ ในบทที่ 2 กล่าวถึงความรู้พื้นฐานของการปลูก ผลึกอิพิแทกซึ่งากลำโมเลกุล กลไกการเกิดผลึกในกระบวนการปลูกผลึกอิพิแทกซึ่งากลำโมเลกุล และ เทคนิคการปลูกผลึกวิธี Droplet epitaxy ในบทที่ 3 กล่าวถึงรายละเอียดและขั้นตอนการทดลองเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ใช้ในการประดิษฐ์โครงสร้างนาโนโฮลด้วยวิธีครอปเพลทอิพิแทกซี ในบทที่ 4 กล่าวถึงผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง ในบทที่ 5 กล่าวถึงการสาธิตของการประยุกต์ ใช้โครงสร้างนาโนโฮลในการประดิษฐ์โครงสร้างกวอนตัมดอตโมเลกุล ในบทที่ 6 เป็นการสรุปของ โครงงานวิจัยนี้ และในบทที่ 7 ข้อเสนอแนะจากโครงงานวิจัยนี้และแนวในการพัฒนาเพื่อนำผลการทดลอง ใปประยุกต์ใช้งานต่อไปอนาคต

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน

สำหรับในบทนี้เป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้โดยสังเขป ซึ่งมีสาระเนื้อหา เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปลูกผลึกอิพิแทกซึ่งากลำโมเลกุล (Molecular Beam Epitaxy : MBE) กลไกที่เกิดขึ้น ในกระบวนการปลูกผลึกอิพิแทกซีวิธี MBE เทคนิคการประดิษฐ์โครงสร้างขนาดนาโนด้วยเทคนิค ครอปเพลทอิพิแทกซี และความรู้พื้นฐานของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V

2.1 การปลูกผลึกอิพิแทกซี่จากลำโมกูล

การปลูกผลึกอิพิแทกซี่งากลำโมกูลหรือ MBE เป็นเทคนิคการปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำ บนผิวของแผ่นผลึกฐาน (Substrate) ที่เป็นผลึกเคี่ยว (Single Crystal) โดยการพ่น ไอของลำโมเลกุลหรือ อะตอมของธาตุที่เป็นวัตถุดิบลงบนผิวหน้าของแผ่นผลึกฐาน ซึ่งโมเลกุลที่มีส่วนที่เป็นองค์ประกอบ หรืออะตอมที่เป็นองค์ประกอบทำปฏิกิริยากันกลายเป็นชั้นผลึกของสารประกอบสารกึ่งตัวนำบนผิวหน้า ของแผ่นผลึกฐาน และไอของลำโมเลกุลเหล่านั้นได้จากการระเหยหรือระเหิด (Evaporation) วัตถุดิบที่มี ธาตุหรือเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบ (Constituent species) ภายใต้สภาวะสุญญากาศระคับ สูงพิเศษ (Ultra-high Vaccum) ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบนี้เกิดขึ้นที่ผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานภายใต้ สภาวะที่เหมาะสม ค่าสัคส่วนของสารประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นผลึกอิพิแทกซีที่ปลูก ้ได้นั้นขึ้นกับเงื่อนไขและตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกผลึก ได้แก่ อัตราส่วนก่าความดันไอของลำโมเลกุล ที่เป็นองค์ประกอบ อุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการปลูก ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ค่าอัตราการปลูกผลึก ้นี้ขึ้นค่าความคัน ไอขององค์ประกอบที่มีคุณสมบัติการเกาะติค (Impinging) ผิวหน้าของแผ่นผลึกฐาน ้สำหรับข้อคีของการปลูกผลึกอิพิแทกซีวิธี MBE ได้แก่ การเตรียมผิวแผ่นผลึกฐานสามารถทำได้ง่าย โดย วิธีการทำความสะอาคด้วยความร้อน (Thermal cleaning) ภายใต้สภาวะสุญญากาศระดับสูงพิเศษ ความ สามารถในการตรวจสอบ (Monitoring) โครงสร้างผิว (Surface structure) ที่สามารถกระทำได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการปลูกผลึกจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกผลึก นอกจากนี้การปลูกผลึกอิพิแทกซีวิธี MBE ที่ ้ดำเนินการในระบบสุญญากาศระดับสูงพิเศษ ทำให้ผลึกที่ปลูกได้นั้นมีความบริสุทธิ์สูงกว่าวิธีการอื่นๆ เนื่องจากก๊าซต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลึก ได้แก่ H2O, O2, CO และ CO2 เป็นต้น มีปริมาณที่ต่ำ มากๆ ในสภาวะสุญญากาศระคับสูงพิเศษ จึงให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของผลึกได้ตามที่เราต้องการ ้นอกจากนี้ชุดระบบการปลูกผลึกอิพีแทกซี่จากลำโมเลกุลที่มีสภาวะสุญญากาศระดับสูงทำให้สามารถติด ต่อเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เข้าในระบบ ทำให้สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของผลึกที่ได้ในขณะทำการปลูก หลึกและภายหลังการปลูกผลึก รวมถึงสภาวะบรรยากาศในขณะที่ทำการปลูกผลึกได้ ด้วยอุปกรณ์ วิเคราะห์ต่างๆ ที่ติดตั้งเข้าในระบบ ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวถึงต่อไป

2.1.1 ชุดระบบการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุล

ชุคระบบการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นชุคระบบ MBE ของบริษัท RIBER รุ่น 32 P ซึ่งมีลักษณะเป็นโมดูล (Module) โดยประกอบด้วยส่วน Introduction Chamber ส่วน Thermal Treatment Stage ส่วน Transfer Buffer Chamber และส่วน Growth Chamber ดังแผนภาพในรูปที่ 2.1 โมดูลแต่ละส่วนที่ต่อกันนี้มี Gate Valve ต่อขั้นกลางระหว่างโมดูล โดยจะเปิด Gate Valve ให้ Cassette ที่เป็น Carrier ในการบรรทุก Substrate holder ผ่านเข้า/ออกจากโมดูลส่วนหนึ่งไปยังโมดูลอีกส่วน หนึ่ง และทำการปิดเพื่อแขกสภาวะสูญญากาศของโมดูลแต่ละส่วนให้เป็นอิสระจากกัน ส่วน Introduction chamber เป็นส่วนที่ใช้ในการนำ Substrate เข้าและออกจากระบบ และส่วน Thermal treatment stage ซึ่ง มีสภาวะสุญญากาศในระดับ 10⁻¹⁰ Torr โดยส่วน Introduction chamber นี้มีปัมป์สุญญากาศ (Vacuum pump) จำนวน 2 ชุดคือ Rotary Pump และ Turbo Molecular Pump ทำหน้าที่ปัมป์เพื่อสร้างสภาวะ สูญญากาศระดับปานกลาง (10⁻⁵ Torr) โดย Cassette ที่บรรจุ Substrate holder จากภายนอกสามารถ ลำเลียงผ่านโมดูลส่วนนี้ เพื่อลำเลียงเข้าสู่ระบบ MBE ต่อไป ในทำกลับกันการลำเลียง Cassette ออกจาก ระบบ MBE ก็คำเนินการผ่านส่วน Introduction chamber เช่นเคียวกัน และทำการปรับสภาวะจากสุญญากาศ สู่สภาวะบรรยากาศปกติด้วยการเติมก๊าซไนโตรเจนสะอาค ส่วน Thermal treatment stage เป็นส่วนที่ใช้ใน การทำ Outgassing แผ่นผลึกฐานก่อนการปลูกผลึกด้วยความร้อน เพื่อไล่ความชื้นและขจัดออกไซด์ (บาง ส่วน) ที่ผิวของแผ่นผลึกฐาน ในส่วนนี้มีปัมป์สุญญากาศจำนวน 2 ชุดคือ Ion Pump และ Ti sublimation Pump ส่วน Transfer buffer chamber เป็นส่วนที่ใช้ในการลำเลียง Substrate Holder เข้าหรือออกจากส่วน Growth chamber และเก็บ Substrate holder เพื่อรอพักสำหรับการปลูกหรือนำออกจากระบบส่วน Growth chamber เป็นส่วนที่กระบวนการปลูกผลึกอิพิแทกซีคำเนินการในโมดูลส่วนนี้ โดยแผนภาพของส่วน Growth chamber ดังรูปที่ 2.1 ส่วนประกอบต่างๆ มีดังนี้ ส่วน Cyopanel เป็นช่องว่างสำหรับรับในโตรเจน เหลวจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่หล่อเย็นระบายความร้อนที่เกิดจาก Effusion Cell ให้แก่ Growth chamber นอกจากนี้ในโครเจนเหลวยังช่วยทำให้สภาวะสุญญากาศในส่วน Growth Chamber ดีขึ้น เนื่องจากความ เย็นของในโตรเจนเหลวทำให้มวลของบรรยากาศภายในมีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้ระบบปั้มป์ สุญญากาศสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในระบบของคณะผู้วิจัยได้แก่ Ga, Al, In, As, P (ได้จากการสลายตัวของ GaP ใน Knuden cell ที่มี Ga-trapping Cap) และ Si (สารเจือปนชนิดเอ็น : n-type Dopant)

นอกจากนี้ในส่วน Growth chamber ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุด Reflection High Energy Electron Diffraction หรือ RHEED, Gas Analyzer หรือ Quadupole Mass Spectrometry (QMS) และ Ionization Gauge ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักพื้นฐานที่มีความสำคัญของระบบ MBE โดย RHEED นี้เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบโครงสร้างผิว นอกจากนี้ RHEED ยังสามารถใช้ในการควบคุมค่าความหนา ของชั้นผลึกในขณะที่ทำการปลูกได้จากปรากฎการณ์ RHEED intensity oscillation ที่เกิดขึ้น โดยเทคนิคนี้ มีชื่อเรียกว่า Phase-locked epitaxy หรือ PLE [7] และ Migration enhanced epiatxy หรือ MEE [8] ที่ สามารถควบคุมค่าความหนาได้ในระดับ Monolayer ของผลึกที่ปลูก นอกจากนี้ RHEED intensity oscillation ยังสามารถบอกค่าอัตราการปลูกผลึกอีกด้วย ส่วน QMS หรือ Gas analyzer เป็นเครื่องมือที่ใช้ ครวจสอบสภาวะบรรยากาศภายใน Growth chamber และ Ionization gauge เป็นเครื่องมือที่ใช้ไนการวัด เทียบค่าความคันไอของลำโมเลกุลต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกผลึกแต่ละครั้ง เพื่อปรับแต่งเงื่อนไขค่าความคันใด ขององค์ประกอบต่างๆ ในการปลูกผลึกแต่ละครั้งให้ได้เงื่อนไขตามที่ต้องการ ในปัจจุบันระบบ MBE ได้มี การพัฒนาให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลึกเข้าไปในระบบ MBE ได้แก่ Ellipsometer ที่ใช้ในการควบคุมค่าความหนา (Thickness) และวิเคราะห์ค่าสัคส่วน (Composition) ของผลึกในขณะที่ทำการปลูก ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการทำงาน อันช่วยให้เรา สามารถควบคุมกระบวนการปลูกผลึก การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของผลึกที่ปลูกได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถติดตั้ง Pyrometer ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของผลึกที่ปลูกได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถติดตั้ง Pyrometer ที่ใช้ในการตรวจลอบอุณหภูมิผิวหน้าของแผ่นผลึก ซึ่งให้ความแม่น อำกว่าเทอร์โมคัปเปอร์ (Thermocouple) ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการสามารถทำได้อย่าง สะควก รวดเร็วและน่าเชื่อถือ



รูปที่ 2.1 ภาพโครงสร้างชุดระบบ MBE ของ RIBER รุ่น 32 P

2.1.2 Effusion Cell

Effusion Cell เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญของระบบ MBE โดยหน้าที่ของ Effusion cell เป็นแหล่ง กำเนิคลำโมเลกุลขององค์ประกอบจากวัตถุคิบที่ใช้ในการปลูกผลึก ซึ่งวัตถุคิบนี้เป็นธาตุบริสุทธิ์หรือสาร ประกอบที่มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบก็ได้ และความสำคัญของ Effusion Cell นั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ การปลูกผลึกวิธี MBE มีข้อคีเด่นที่เหนือกว่าเทคนิคอื่นๆ ซึ่ง Effusion Cell แต่ละชนิดนั้นมีความเหมาะสม สำหรับวัสดุแต่ละชนิคแตกต่างกันซึ่งในรายงานวิจัยนี้นำเสนอเฉพาะ Effusion Cell ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก ผลึกอิพิแทกซีของ GaAs และ InP เท่านั้น

2.1.2.1 Knudsen Cell

Knudsen Cell หรือ K-cell เป็น Effusion Cell แบบที่ง่ายที่สุด ซึ่งใช้ในการระเหยหรือระเหิด (Evaporate) วัตถุดิบให้เป็นลำโมเลกุลด้วยพลังงานความร้อน สำหรับโครงสร้างของ Knudsen Cell ดังใน รูปที่ 2.2 วัถตุดิบที่ใช้ถูกบรรจุไว้ในเบ้าหลอม (Crucible) ซึ่งทำจากวัสดุ Pyrolytic boron nitride หรือ PBN โดยเบ้าหลอมนี้ถูกล้อมรอบด้วยขดลวดความร้อน (Heating elements) โดยขดลวดความร้อนเป็นตัว กำเนิดความร้อนให้แก่เป้าหลอมจากขดลวดความร้อนที่มีการป้อนผ่านกระแสไฟฟ้า และที่ใต้เบ้าหลอมนี้มี เทอร์โมคัปเปอร์ดิดตั้งอยู่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิและควบอุมก่ากระแสไฟฟ้า ที่ใหลในขดลวด ความร้อนให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ ด้วยสัญญาณจากเทอร์โมคัปเปอร์ที่ต่อเข้ากับเครื่องควบอุมแบบ PID ที่ทำหน้าที่ควบอุมแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้ขดลวดความร้อนของ Effusion cell เพื่อทำให้เบ้า หลอมมีอุณหภูมิตามที่กำหนด สำหรับ K-Cell ที่มีเบ้าหลอมขนาดใหญ่นั้นจำเป็นด้องมีท่อน้ำระบายความ ร้อนอยู่ภายใน เพื่อให้ป้องกันมิให้ความร้อนที่เกิดขึ้นไปรบกวนส่วนอื่นๆ อีกด้วย



รูปที่ 2.2 แผนภาพ โครงสร้าง Knudsen Cell

สำหรับการควบคุมปริมาณของจำนวนโมเลกุลที่พ่นออกจาก Knudsen Cell ควบคุมได้จาก อุณหภูมิของขดลวดความร้อนภายใน Knudsen Cell ซึ่งปริมาณของจำนวนโมเลกุลของสารที่พ่นออกจาก Knudsen Cell สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$J = 1.118 \times 10^{22} \frac{pA}{l^2 \sqrt{MT}}$$
 molecules/cm²-s (2.1)

โดย p คือค่าความคันไอของธาตุหรือสารที่อุณหภูมิกำหนคมีหน่วยเป็นทอรร์ (Torr)

A คือพื้นที่บริเวณปากช่องเปิดของ Knudsen Cell (Cell orifice area) มีหน่วยเป็น ตร. ซม.

- / คือค่าระยะห่างจากปากช่องเปิดของ Knudsen Cell ถึงผิวหน้าของผลึกฐานมีหน่วยเป็น ซม.
- M คือค่ามวล โมเลกุลขององค์ประกอบที่เป็นวัตถุดิบมีหน่วยเป็น AMU

T คือค่าอุณหภูมิองศาสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุใน Knuden Cell มีหน่วยเป็นเคลวิน (K)

สำหรับค่าอัตราการปลูกผลึก (Growth rate) ของการปลูกผลึกวิธี MBE สำหรับสารประกอบกลุ่ม III-V นี้ขึ้นกับจำนวนโมเลกุลของธาตุหมู่ III เช่นกรณีของ GaAs ค่าอัตราการเกิดผลึกสามารถคำนวณได้ จากสมการ

$$R = \alpha J_{Ga} \tag{2.2}$$

โดย R คืออัตราการเกิดผลึกมีหน่วยเป็น ไมครอน/ชั่วโมง

α คือค่าคงที่ ซึ่งก่าคงที่นี้ขึ้นกับก่าอุณหภูมิและทิศทางผิวหน้าของแผ่นผลึกฐาน

กลไกการเกิดผลึกของสารประกอบกลุ่ม III-V นั้นถูกกำหนดจากอะตอมของธาตุหมู่ III ใน สภาวะก๊าซที่ถูกพ่นไปยังผิวหน้าของผลึกแผ่นฐานเป็นหลัก อันเนื่องจากอะตอมของธาตุหมู่ III มี ก่าสัมประสิทธิ์การเกาะติด (Sticky coefficient) สูงกว่าอะตอมของธาตุหมู่ V โดยกลไกการเกิดผลึกขึ้นกับ ก่าอัตราการพ่นของธาตุ III จาก K-cell ที่เกาะลงบนผิวหน้าของแผ่นผลึกฐาน จากนั้นจะทำปฏิกิริยาทาง เกมีกับอะตอมของธาตหมู่ V รวมตัวกันเป็นสารประกอบ และเรียงตัวเป็นผลึกตามโครงสร้างของแผ่น ผลึกฐาน ตัวอย่างเช่น In-As ที่ได้จากลำโมเลกลของ In และ As, หรือ As, และ Ga-As ที่ได้จากลำโมเลกุล ของ Ga และ As, หรือ As, ทำปฏิกริยากันที่ผิวหน้าของผลึกแผ่นฐาน แล้วก่อให้เกิดพันธะขึ้นเป็นโครงผลึก ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับของแผ่นผลึกฐาน โดยกระบวนการเกิดผลึกนี้ขึ้นกับพลังงานกระตุ้นที่ให้แก่โมเลกุล เหล่านั้น ได้แก่ ความร้อนจากอุณหภูมิของผลึกแผ่นฐาน และพลังงานจลน์ของโมเลกุลที่ได้จาก Knudsen cell

อย่างไรก็ตาม Knudsen cell นั้นมีขีดจำกัดสำหรับสารหรือธาตุบางชนิด เนื่องจากไม่เหมาะสม สำหรับในการผลิตลำโมเลกุลของสารหรือธาตุที่มีก่ากวามดันไอสูงได้ ด้วอย่างเช่น P, S, Se และ Te เป็นต้น เนื่องจากการควบกุมก่ากวามดันไอทำได้ยาก ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนา Effusion Cell ที่มี กุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ Valved cracker cell สำหรับสารที่มีก่ากวามดันไอสูงเหล่านี้ แต่อย่างไรก็คี Valved cracker cell นั้นมีรากาแพงและ โกรงสร้างซับซ้อน สำหรับสิ่งประดิษฐ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้ออกแบบมาเพื่อ ใช้ร่วมกับ Knudsen cell แบบธรรมดานี้ เพื่อใช้ในการผลิตลำโมเลกุลชนิด Dimer ของ As (As₂) และ P (P₂) ได้แก่ Ga-trapping cap วัตถุดิบที่ใช้ในการนี้เป็นสารประกอบ GaAs และ GaP เนื่องจากมีราคาถูกและ อุณหภูมิของการสลายตัวมีค่าไม่สูงเกินไป จากก่าความแตกต่างของกำความดันไอระหว่าง Ga และ P ที่ ได้จากการสลายตัวของสารประกอบในสภาวะสมคูลนั้น โดยก่าความดันไอของ Ga มีก่าต่ำกว่าใอของ As₂ หรือ P₂ ที่อุณหภูมิเดียวกัน ดังนั้นไอของ Ga ถูกกักไว้ภายในภาชนะเบ้าหลอมหรือ Crucible ของ Knudsen cell ด้วยส่วน Ga-trapping cap นอกจากนี้ส่วน Ga-trapping cap ยังช่วยในการรักษาสภาวะสมคูลของไอ ในสภาวะที่เกิดกลไกการสลายตัว (Decomposition) ของสารประกอบอีกด้วย สำหรับการสลายตัวของสาร ประกอบดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากความร้อนหรือการทำให้สารประกอบอยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูง ซึ่งในสภาวะ สมดุลนี้สารประกอบกลุ่ม III-V มีจำนวนหรือปริมาณของอะตอมธาตุหมู่ III มากกว่าของธาตุหมู่ V และ ในสภาวะอุณหภูมิสูงนี้ธาตุหมู่ V ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ Dimer (V₂) แต่เนื่องจากก่าความดันไอของ โมเลกุล Dimerของหมู่ V นั้นมีก่าสูงกว่า จึงทำให้โมเลกุลของ Dimer ที่เกิดขึ้นถูกพ่นออกมาเป็นโมเลกุล หลักเพียงอย่างเดียว ตามปกติอุณหภูมิจุดทำงานของการกำเนิดไอ As₂หรือ P₂ มีก่าสูงกว่าอุณหภูมิการ สลายตัวโลรงสร้างของ Ga-trapping cap ดังในรูปที่ 2.3



Gallium Trapping Cap System

รูปที่ 2.3 ภาพ โครงสร้างของ Effusion ที่มี Ga-trapping cap [9]

2.1.2.2 Cracker cell

Cracker cell มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Dissociation cell เป็น Effusion cell ที่ออกแบบเพื่อใช้เป็น แหล่งกำเนิดลำโมเลกุลของธาตหมู่ V ชนิด Dimer (V₂) ซึ่งตามปกติลำโมเลกุลของธาตุหมู่ V ที่ได้จาก Effusion cell นั้นเป็นโมเลกุลชนิด Tetramer (V₄) (ด้วอย่างเช่น As มี As₂ เป็นโมเลกุล Dimer และ As₄ เป็นโมเลกุล Tetramer) โครงสร้างของ Cracker cell มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Knudsen cell แต่ Cracker cell นั้นมี Cracking zone ซึ่งเป็นส่วนของขดลวดความร้อนอีกชุดหนึ่งที่ให้อุณหภูมิสูงในช่วง 800-1000^oC ที่ปลายของช่องทางออก เพื่อทำให้โมเลกุล Tetramer แตกตัวเป็นโมเลกุล Dimer และ ในการออกแบบนั้นมี ข้อกวรระวังคือด้องให้ส่วน Cracking zone อยู่ห่างจาก Crucible หรือ Reservoir ที่บรรจุวัตถุดิบมากเพียงพอ เพื่อมิให้ความร้อนจาก Cracking zone ซึ่งมีค่าอุณหภูมิสูงรบกวนส่วน Crucible อันมีผลต่อการควบคุมค่า กวามคันไอได้ ดังนั้น Effusion cell ชนิดนี้จึงมีความยาวมากกว่า Knudesn Cell แบบปกติและจำเป็นต้อง มีส่วนของท่อน้ำหรือส่วนระบายความร้อนในลักษณะอื่นๆ สำหรับทำหน้าที่เป็นระบบระบายความร้อน (Cooling) เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิในส่วน Crucible สามารถทำได้ สำหรับโครงสร้างแบบง่ายของ Cracker cell ดังในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 ภาพโครงสร้างของ Cracker Cell

Valved cracker cell เป็น Effusion cell ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดลำโมเลกุลชนิด Dimer ของธาตุหมู่ V ซึ่ง Valved cracker cell มีกลไกของ Nozzle valve ที่ใช้ในการควบกุมค่าความคัน ใองากการปรับตำแหน่งของ Nozzle ในการเปิดช่องทางออกของลำโมเลกุล รวมถึงความสามารถในการ ปิดกักใอไว้ภายใน Reservoir เพื่อไม่ให้ไอออกมาได้ในกรณีที่เราไม่มีความต้องการ ทำให้มีความกล่องตัว ในการกำหนดค่าความคัน ไอตามเงื่อน ไขที่ต้องการได้ง่ายและความสามารถในการตัดลำโมเลกุล ได้ดีกว่า Effusion cell ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะการปลูกผลึกของ โครงสร้างเฮตเทอโร (Heterostructure) ที่มีสาร ประกอบของธาตุหมู่ V ที่ต่างชนิดกัน สำหรับข้อดีของ Valved cracker cell คือสามารถใช้วัตถุดิบได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจาก Knudsen cell และ Valved cracker cell คือวัตถุดิบภายในนั้นถูกทำให้ กลายเป็นไอระเหิดออกมาตลอดเวลา ถึงแม้ว่า Shutter อยู่ในตำแหน่งปิดก็ตาม

^{2.1.2.3} Valved cracker cell



รูปที่ 2.5 ภาพของ Arsenic Valve Cracker Cell [10]

2.1.2.4 Gas Injector Cell

Gas Injector Cell เป็น Effusion Cell ที่ใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบ ซึ่งอยู่ในรูปของ Hydride สำหรับ แหล่งจ่ายธาตุหมู่ V เช่น PH,, AsH, และ Organic compound สำหรับแหล่งจ่ายธาตุหมู่ III ด้วอย่างได้แก่ Ga(CH,), (Trimethyl Gallium : TMGa) และ In(CH,), (Trimethyl Indium : TMIn) เป็นด้น โดยโครงสร้าง ของ Gas injector cell มีลักษณะคล้ายกลึงกับ Knuden cell แต่แตกต่างกันที่ Effusion cell ชนิดนี้มีขด ลวดความร้อนที่ใช้นั้นมีอุณหภูมิสูงกว่า โดยหน้าที่ขดลวดความร้อนทำให้ก๊าซที่ใหลผ่านแตกด้วออก เป็น โมเลกุลแบบ Dimer หรือ Tetramer สำหรับธาตุหมู่ V และเป็นอะตอมเดียวสำหรับธาตุหมู่ III ซึ่ง สามารถควบดุมได้จากค่าอุณหภูมิในส่วน Cracking zone สำหรับข้อดีของการใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบคือความ ด่อเนื่องและความสะดวกในการเติมก๊าซวัตถุดิบ โดยไม่มีความจำเป็นในการทำให้ระบบรั่วก่อนการเติม วัตถุดิบเช่นระบบ MBE ทั่วๆ ไป เนื่องจากวัตถุดิบนั้นถูกเก็บไว้ในท่อก๊าซที่ต่อเข้าระบบ MBE ซึ่ง สามารถปิดท่อของระบบการป้อนก๊าซที่ต่อเข้าระบบและทำการเปลี่ยนท่อก๊าซได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ สามารถปิดท่อของระบบการป้อนก๊าซที่ต่อเข้าระบบและทำการเปลี่ยนท่อก๊าซได้ โดยไม่มีความจำเป็นที่คือง ก๊อตั้งระบบปัมป์สูญญากาศที่มีขนาดกำลังสูงเพียงพอ และปัมป์ที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่มีความคงทนต่อการกัด กร่อนของก๊าซเหล่านั้น

จุณภาพลำโมเลกุลที่ได้จาก Effusion cell นั้นมีผลต่อคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลึก ดังนั้น ลำโมเลกุลที่ได้นั้นด้องมีเสถียรภาพ (Stable) ความสม่ำเสมอ ความสะอาดขององค์ประกอบต่างๆ ของ Effusion cell และความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของลำโมเลกุล ลำโมเลกุลชนิด ต่างๆ ของธาตุหมู่ V และชนิด Effusion cell และวัตถุดิบที่ใช้สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.1



รูปที่ 2.6 ภาพโครงสร้างของ Effusion cell ชนิค Gas injector Cell [11]

A	a a a	Sec. 4		0 4	s al	12	~	9	9 1	
a1513W 21	ตารางเรารทราแทยราด	Effusion cell	และชาเตของก	a1	าแลกลท	ดจ	າງຄາສາ	າດາເ	କ୍ୟାରଗ	1.99
111 1411 2.1	HIS HS DO DO HOLD DIGHT	Linusion con	SSEID DISTI UO VI		Devisorialist	BFI C	111 avie	1111	The section	1.4

	ชนิคของถ้าโมเลกุล						
Effusion Cell	P ₂	As ₂	As ₄	Sb ₂	Sb ₄		
Knundsen Cell	GaP	GaAs	Solid As	Solid Sb	Solid Sb		
Cracking Cell	Solid P	Solid As	Solid As	Soild Sb	Soild Sb		
Valve Cracking Cell	Solid P	Solid As	Solid As	Soild Sb	Soild Sb		
Gas Injector Cell	PH ₃	AsH ₃		SbH ₃	سمر		

2.1.3 อุปกรณ์วิเคราะห์

ข้อเค่นของระบบ MBE ที่เหนือกว่าวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีวิธีอื่นๆ ในเชิงเทคนิคก็คือสามารถ ดิดตั้งอุปกรณ์วิเคราะห์ต่างๆ เข้ากับระบบได้ ทำให้มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ และคุณสมบัติผลึกในขณะที่ทำการปลูกผลึกได้ จึงทำให้สะดวกและมีความคล่องตัว ซึ่งเหมาะสมสำหรับ การวิจัยและการผลิตเชิงพาณิชย์ สำหรับในรายงานนี้ขอกล่าวถึงโดยสังเขปเฉพาะอุปกรณ์วิเคราะห์หลัก พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับระบบ MBE เท่านั้น

2.1.3.1 Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED)

RHEED เป็นเครื่องมือหลักพื้นฐานที่สำคัญชนิดหนึ่งในระบบ MBE ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบโครงสร้างผิว (Surface Structure) โดยข้อมูลที่ได้จาก RHEED นี้บ่งบอกรูปแบบของลักษณะ โครงสร้างผิวในเชิง Microstructure และความเรียบของผิว (Smoothness) ซึ่งลักษณะรูปแบบ (Pattern) ที่ ได้จาก RHEED นี้ขึ้นกับลักษณะการเรียงตัวของอะตอมในโครงร่างผลึก และความเรียบของผิวมีผลทำให้ ลำอิเล็กตรอนเบี่ยงเบน (Diffraction) ไปในลักษณะ 3 มิติ อันเป็นเหตุทำให้รูปแบบของ RHEED ที่ปรากฏ ขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี

สำหรับหน้าที่หลักสำคัญของ RHEED ที่สรุปไค้มีคังนี้

1.การตรวจสอบสภาพผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานในขณะที่ทำความสะอาคด้วยความร้อน (Thermal Cleaning) ก่อนการปลูกผลึก

2. การควบคุมสภาวะเริ่มต้นของการปลูกผลึก

3. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผิวในขณะที่ทำการปลูกผลึก

นอกจากนี้ RHEED ยังสามารถใช้ในการสอบเทียบค่าอัตราการปลูกผลึก (Growth Rate Calibration) ได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสง RHEED ในขณะที่ทำการปลุกผลึก ซึ่ง สามารถอธิบายได้ในรูปที่ 2.7 ตามปกติผิวหน้าของผลึกก่อนการปลูกผลึกมีความเรียบ ทำให้อิเล็กตรอน สามารถสะท้อนผ่านผิวหน้าผลึกที่มีอะตอมเรียงตัวเป็นระเบียบ ซึ่งความเข้มของอิเล็กตรอนที่สะท้อนผ่าน ไปในกรณีนี้มีค่าความเข้มสูงสุด แต่เมื่อการปลูกผลึกเริ่มต้นขึ้นการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสง RHEED มีค่าลดลง ในขณะที่ทำการปลูกผลึกนี้เกิดจากการกระเจิง (Scattering) ของลำอิเล็กตรอนตาม ส่วนของผลึกขนาดเล็กที่กระจายบนผิวหน้าของแผ่นผลึกฐาน อันเนื่องจากผลึกที่เกิดขึ้นนั้นบนผิวหน้า ของแผ่นผลึกเกิดการเรียงตัวของก้อนผลึกขนาดเล็ก (Cluster) โดยก้อนผลึกขนาดเล็กที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะ กระจัดกระจายไม่เป็นระบียบ อันเป็นผลทำให้ความเข้มของลำเอ็กตรอนมีก่าลคลง จนกระทั่งพื้นที่ของก้อน ผลึกขนาดเล็กเหล่านั้นปกคลุมผิวหน้าของผลึกมากกว่าครึ่งหนึ่ง ความเข้มแสงของ RHEED จะกลับมามี ความเข้มเพิ่มขึ้นอีกจนมีค่าสูงสุดเมื่อผลึกเรียงเต็มผิวหน้าแผ่นผลึกฐาน ซึ่งความสัมพันธ์ของการเปลี่ยน แปลงของความเข้มและก่าความหนาของผลึกที่เกิดขึ้นนี้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบคลื่นรูปไซน์ (Sine) โดยการเปลี่ยนแปลงก่าความเข้มหนึ่งรอบในการเปลี่ยนแปลงความหนาหนึ่งชั้นโมเลกุล (Monolayer) ด้วย เหตุนี้เองทำให้เราสามารถควบคุมค่าความหนาของชั้นผลึกที่ได้ในระคับชั้นโมเลกุลจากการสังเกตการ เปลี่ยนค่าความเข้ม RHEED ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ทำการปลูกผลึก โคย RHEED เป็นเครื่องมือสำคัญ ในเทคนิก PLE และ MEE ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นเทคนิคสำคัญในการ สังเกตการก่อตัวของโครงสร้าง Quantum Dot จากกลไก Stranski-Krastanow แต่อย่างไรก็คึเทคนิคนี้มีขีด จำกัดคือการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสงไม่ชัคเจนสำหรับการปลูกผลึกของสารประกอบบางชนิดและ การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มแสง RHEED นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขในสภาวะที่ แตกต่างกันอีกด้วย สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะขอไม่กล่าวถึงในที่นี้



รูปที่ 2.7 แผนภาพอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงความเข้มของอิเล็กตรอนในขณะทำการปลูกผลึก

นอกจากนี้รูปแบบ (Pattern) ของ RHEED ที่ได้ของผลึกแต่ละชนิดสามารถบ่งบอกถึงช่วงค่า อุณหภูมิของผิวหน้าผลึกได้ด้วยดังตัวอย่างในรูปที่ 2.8 ซึ่งปัจจุบันยังนิยมใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบอุณหภูมิ ผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานในการปลูกผลึกวิธี MBE และสามารถใช้ได้กับสารประกอบเกือบทุกชนิด โดย เฉพาะสารประกอบกึ่งตัวนำที่ค่าแถบพลังงานมีค่าน้อยมาก อันเป็นข้อดีที่เหนือกว่าวิธีการวัดด้วย Pyrometer ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ [12] แต่อย่างไรก็ดีวิธีการนี้มีความคลาดเคลื่อนมากกว่า 10°C และมีความ ยุ่งยากในการอ่านรูปแบบของ RHEED ในการวัดเทียบอุณหภูมิ โดยขึ้นกับความชำนาญมากของผู้อ่าน เป็นอย่างมาก



รูปที่ 2.8 แผนภาพความสัมพันธ์ของรูปแบบ RHEED และอุณหภูมิของแผ่นผลึก (100) GaAs, InP และ InAs ภายใต้ไอของ Dimer [13]

2.1.3.2 Residual Gas Analyzer

Residual Gas Analyzer หรือ Quadupole Mass Spectrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ชนิดและปริมาณของอนุภาคที่เป็นก๊าซภายใน Growth Chamber ซึ่งทำให้เราสามารถรู้สภาพบรรยากาศ ภายใน Growth Chamber นอกจากนี้ Residual Gas Analyzer ยังสามารถใช้วิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ (Composition) ของสารประกอบในขณะที่ทำการปลูกผลึกได้เช่นกัน [14] โดยข้อดีของ Residual Gas Analyzer ที่เหนือกว่าการใช้ Ionization gauge คือ Residual Gas Analyzer มีความละเอียดและความแม่นยำ สูงกว่า อีกทั้งไม่มีผลของการเสื่อมของความไว (Sensitivity) เช่นเดียวกับ Ionization gauge เมื่อใช้งานไป ระยะเวลาหนึ่ง

2.1.3.3 อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถติดตั้งเข้าในระบบ MBE

นอกจาก RHEED, Ionization Gauge, และ Residual Gas Analyzer ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักพื้นฐานที่ ติดตั้งในส่วน Growth Chamber ของระบบ MBE อุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งเพื่อช่วยให้การปลูกผลึกสามารถทำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Pyrometer เพื่อใช้ในการวัคอุณหภูมิผิวหน้าแผ่นผลึกฐาน Ellipsometor เพื่อ ใช้ในการควบคุมค่าความหนาและค่าอัตราส่วนของสารประกอบได้แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะของระบบ MBE ที่เป็นโมดูลที่มีสภาวะสุญญากาศระดับพิเศษทำให้เราสามารถติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เข้ากับ ระบบ MBE ใด้ ตัวอย่างเช่น Auger Electron Spectroscopy (AES), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Secondary Ion Microscopic Spectroscopy (SIMS), Scanning Tunnelling Microscope (STM) เป็นต้น จึงทำให้เราสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของผลึกที่ปลูกได้อย่างต่อเนื่องและรวคเร็ว โดยเฉพาะ STM เป็นเครื่องมือที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจกลไกต่างๆ ใน ระดับขนาดของอะตอม [15] ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องมือเหล่านั้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก เอกสารอื่นๆ สำหรับรายการของส่วนประกอบพื้นฐานใน Growth chamber สรุปไว้ในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 รายการส่วนประกอบพื้นฐานใน Growth Chamber ของระบบ MBE

ส่วน (Facilities)	รายการเครื่องมือ (Component)	หน้าที่ (Function)
Beam Generators	Knudsen cell Cracker cell Valved cracker cell Gas injector cell	แหล่งจ่ายลำ โมเลกุลหรืออะตอม
Beam Interruptors	Shutter	ทำหน้าที่เปิด-ปิดลำโมเลกุลที่พ่นสู่ ผิวหน้าของแผ่นผลึกฐาน เพื่อใช้ใน การถวบคุมกระบวนการปลูกผลึก
Beam and Growth Monitors	RHEED Quadupole mass spectrometer Ionization gauge	วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผิว ข้อมูลค่าความคันไอของลำโมเลกุล และค่าอัตราส่วน
Process Environment	Multichamber UHV system	ระบบ Multichamber ช่วยให้ สามารถลดปริมาณของ residual gas ที่ active (ได้แก่ O ₂ , CO ₂ , H ₂ O, C ₂ O) ทำให้สามารถปลูกผลึกที่มี ความบริสุทธ์สูง

2.2 กลไกการเกิดผลึกของการปลูกผลึกอิพิแทกซีวิธี MBE

กลไกการเกิดผลึกของการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสำหรับสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V นั้นเกิดจากอะตอมของธาตุหมู่ III เป็นหลัก เนื่องจากความสามารถของการเกาะติดผิวแผ่นผลึกฐาน ของธาตุหมู่ III ซึ่งตามปกติแล้วผิวหน้าแผ่นผลึกฐานก่อนการปลูกถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศของ โมเลกุลธาตุหมู่ V เพื่อชดเชยการสูญเสียในขณะที่แผ่นผลึกฐานมีก่าอุณหภูมิสูง อันเป็นผลทำให้ผิวหน้า แผ่นผลึกฐานเป็นชั้นของอะตอม V ดังนั้นอะตอมของธาตุหมู่ III จึงเรียงตัวเกาะลงบนชั้นของอะตอม V จนกลายเป็นชั้นของอะตอม III จากนั้นอะตอมของธาตุหมู่ V ทำปฏิกิริยาเกาะบนอะตอมของธาตุหมู่ III หรือถูกดูดซับ (Adsorp) จากอะตอมของธาตุหมู่ III โดยลักษณะของการเรียงตัวของอะตอมของธาตุหมู่ III และ V นั้นเรียงตัวเป็นชั้นระดับอะตอมสลับกันไปตลอดการปลูกผลึก ซึ่งอะตอมของธาตุหมู่ V ได้จาก การแตกตัวของโมเลกุลที่อยู่ในรูป Dimer หรือ Tetramer ทำให้กระบวนการเกิดผลึกเป็นลักษณะได้สัด ส่วนขององก์ประกอบตามโครงสร้าง (Stoichiometric) โดยโมเลกุลส่วนเกินของธาตุหมู่ V นั้นถูกปล่อย ดาขออก (Desorp) จากผิวของแผ่นผลึกฐาน แต่อย่างไรก็ตามอุณหภูมิผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานมีความสำคัญ สำหรับการปลูกผลึกวิธีนี้ ดังนั้นหากอุณหภูมิผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานมีค่าสูงทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

ก) ในกรณีที่อุณหภูมิผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานมีค่าสูงกว่าจุดระเพิดของธาตุหมู่ ∨ ทำให้เกิดการ
ปล่อยดายอะตอมของธาตุหมู่ ∨ ออกจากผิวแผ่นผลึกฐาน

ข) ในกรณีที่อุณหภูมิผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานมีก่าสูงขึ้นและมีก่าสูงกว่าจุคระเหิดของของธาตุหมู่
III ทำให้เกิดการปล่อยกายอะตอมของธาตุหมู่ III ออกจากผิวแผ่นผลึกฐาน

ดังนั้นอุณหภูมิของแผ่นผลึกฐานจึงกวรอยู่ในระดับที่ไม่เกิดสาเหตุในข้อ ข) จึงมีกวามจำเป็นที่ต้อง ทำการชดเชยอะตอมธาตุของหมู่ ∨ ที่สูญเสียไป เนื่องจากผลในข้อ ก) ซึ่งก่าอุณหภูมิการระเหิดของสาร ประกอบชนิดต่างๆ มีก่าตามตารางที่ 2.3

สารประกอบ	T _{CS} (°C)	T _{max(V4)} (°C)	T _{max(V2)} (°C)	J_{V4}/J_{H1}
AlP	>700	640	700	~1.0/1
GaP	670	490	750	~1.0/1
InP	363	>450	>500	~3.0/1
AlAs	>750	630	750	~1.5/1
GaAs	~620	480	>760	~1,0/1
InAs	~370	~450	~550	~5.0/1

ตารางที่ 2.3 อุณหภูมิจุดระเหิดของสารประกอบ III-V ชนิดต่างๆ [16]

T_{CS} หมายถึงอุณหภูมิของการระเพิด (Congruent Sublimation Temperature) T_{max}(V₄) หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดภายใต้บรรยากาศ tetramer โมเลกุลของธาตุหมู่ V T_{max}(V₂) หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดภายใต้บรรยากาศ dimer โมเลกุลของธาตุหมู่ V J_{V4}/J_{III} หมายถึงก่าอัตราส่วน flux ของ V/III ที่เกิดจากการสลายตัว (Decomposition)

การอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำ โมเลกุลนั้นเราสามารถใช้แบบจำลอง ตามรูปที่ 2.9 และ 2.10 อันเป็นตัวอย่างของ GaAs ซึ่งปฏิกิริยานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณีคือกรณีของ Ga-As2-(100) GaAs และกรณีของ Ga-As4-(100) GaAs สำหรับในกรณี Ga-As2-(100) GaAs ปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นเริ่มต้นจากอะตอมของ Ga เกาะติดบนผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานและเรียงตัวเป็นชั้น (layer) จาก นั้นโมเลกุล As₂ ทำปฏิกิริยากับอะตอมของ Ga โดยแตกตัวเป็นอะตอม As และเกาะตัวบนชั้นอะตอม Ga สำหรับอัตราการเกาะของโมเลกุล As, ที่ผิวหน้าแผ่นผลึกฐานขึ้นกับค่า Flux ของ Ga สำหรับโมเลกุล As, ส่วนเกินนั้นจะระเหิดไปในรูปของโมเลกุล As, และ As, ทำให้การเกิดผลึกเป็นแบบ Stoichiometric Growth ดังในรูปที่ 2.9 สำหรับกรณี Ga-As₄-(100) GaAs นั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนกว่า โดยโมเลกุล As, คู่หนึ่งทำปฏิกิริยากับอะตอม Ga ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอะตอม Ga ได้เกาะอยู่ที่ผิวหน้าของ แผ่นผลึกฐาน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากโมเลกุล As, แต่ละโมเลกุลแตกตัวให้อะตอม As จำนวน 2 อะตอม เกาะถงบนผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานด้วยการดูคซับ (Adsorp) จากอะตอมของ Ga โดยจำนวนอะตอมของ As ที่เกาะลงบนผิวหน้ามีสัดส่วนเทียบกับจำนวนอะตอมของ Ga ที่เกาะที่ผิวหน้า ส่วนอะตอม As ส่วนที่ เหลือจำนวน 4 อะตอมนั้นจะรวมตัวกันเป็น โมเลกุล As, และถูกปล่อยคาย (Desorp) ออกจากผิวไป ดังนั้น ในกรณีนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ค่าความหนาแน่นของโมเลกุล As, หรือ Flux ของ As, (J_{As}) มีค่า มากกว่าค่าความหนาแน่นของโมเลกุล Ga หรือ Flux ของ Ga (J_{Ga}) เพื่อให้จำนวนโมเลกุล As, มีจำนวน มากเพียงพอสำหรับปฏิกิริยาที่มีส่วนที่เกาะเรียงดัวในผลึกและส่วนที่ปล่อยคายออก ในขณะที่ทำการปลูก ผลึกนั้นอะตอมของ As สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนหนึ่งที่เกาะถงบนผิว (Adsorp) ของอะตอม Ga เรียงตัวเป็น โครงผลึก และอีกส่วนหนึ่งที่ถูกปล่อยคาย (Desorp) ออกมา ซึ่งเป็นส่วนที่สูญเสียไปและการ สูญเสียนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานมีค่าสูงขึ้น



รูปที่ 2.9 แบบจำลองปฏิกิริยาของการเกิดผลึก GaAs ในกรณี Ga-As₂-(100) GaAs



รูปที่ 2.10 แบบจำลองปฏิกิริยาของการเกิดผลึก GaAs ในกรณี Ga-As₄-(100) GaAs

2.3 เทคนิคการปลูกผลึกดรอปเพลทอิพิแทกซี

เทลนิลการปลูกผลึกครอปเพลทอิพิแทกซีเป็นวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีที่แตกต่างไปจากวิธีการ ปลูกผลึกตามแบบปกติ (Coventional) ซึ่งได้มีการเสนอกรั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1990 โดย Dr. Koguchi [17] ต่อมาเทลนิลนี้ได้ลูกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์โครงสร้างขนาคนาโนแบบต่างๆ ด้วอย่าง เช่นโครงสร้างควอนตัมดอตแบบคู่ โครงสร้างนาโนริงค์แบบคู่ เป็นค้น โดยเทลนิลนี้มีกระบวนหลัก 2 ขั้น ตอนถือกระบวนการขึ้นรูปหยดโลหะและกระบวนการคริสตอลไลเซชัน (Crystallization) หรือกระบวน เปลี่ยนรูปหยดโลหะให้เป็นผลึก ซึ่งเทลนิลเหมาะสำหรับสารประกอบกลุ่มตัวนำ โดยขนาดของรูปหยด โลหะมีขนาดในระดับนาโนเมตรและก่าขนาดของรูปหยดโลหะขึ้นกับเงื่อนไขในการขึ้นรูปหยดโลหะ สำหรับรูปร่างของหยดโลหะนั้นส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเป็นรูปครึ่งทรงกลม และรูปร่างสุดท้ายของหยด โลหะที่เปลี่ยนรูปเป็นผลึกขึ้นเงื่อนไขในกระบวนการคริสตอลไลเซชัน ซึ่งกระบวนการคริสตอลไลเซชัน มีความสำคัญต่อรูปร่างสุดท้ายของโครงสร้างนาโนเมตรดังนี้

สำหรับกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการกริสตอลไลเซชันนั้นเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนรูปหยด โลหะ 2 กลไกที่เกิดการแพร่ (Diffusion) จากแบบจำลองในรูปที่ 2.11 สำหรับกรณีของโครงสร้างขนาด นาโนเมตร GaAs [18] ซึ่งในตอนเริ่มต้นการพ่นไอของ As₄ นั้น กลไกการเกิดผลึกขึ้นเกิดขึ้น 2 กลไกที่ เกิดจากการแพร่ของอะตอม As คือกลไกแรกที่บริเวณผิวขอบรอบนอกวงของหยดโลหะ (Process B) ซึ่ง หยดโลหะ Ga ที่อยู่บนแผ่นผลึกฐานสัมผัสไอ As₄ โดยตรง อันเป็นผลให้หยดโลหะดังกล่าวเปลี่ยนรูปเป็น สารประกอบ GaAs ทันทีจากผิวด้านนอกของหยดโลหะ จากนั้นผลึกจากผิวขอบรอบนอกวงของหยด โลหะนี้จะก่อยขยายตัวเข้าภายในหยดโลหะ โดยผลึกที่ผิวขอบรอบนอกที่เกิดขึ้นนี้มีรูปร่างเป็นวงแหวน กลไกอีกกลไกหนึ่งคืออะตอม As ที่แพร่จากค้านผิวบนของหยดโลหะ (Process A) ซึ่งอะตอม As จะ ทำปฏิกิริยากับโลหะหลอมเหลว Ga กลายเป็นสารละลาย Ga-GaAs โดย GaAs นี้เป็นสารแขวนลอยใน หยดโลหะ และจะกลายเป็นผลึก GaAs เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่ผิวรอยต่อระหว่างหยดโลหะและแผ่นผลึกฐาน จะทำให้เกิดขึ้นผลึกขึ้นที่ผิวของแผ่นผลึกฐาน ซึ่งอัตราการเกิดผลึกบริเวณผิวรอบต่อระหว่างหยดโลหะ และแผ่นผลึกฐานสำหรับกลไกการเกิดผลึกในกระบวนนี้ขึ้นกับค่าอัตราการแพร่ของ As สำหรับค่าอัตรา การแพร่ของ As ในกรณีนี้ขึ้นกับค่าความดันไอของ As₄ และค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะที่ทำการคริส ตอลไลเซชัน โดยตัวแปรสำคัญในการกำหนดรูปร่างในที่นี้ถูกกำหนดจากอัตราการเกิดผลึกที่ผิวขอบ รอบวงของหยดโลหะ (Process B) และผิวรอยต่อระหว่างหยดโลหะและแผ่นผลึกฐาน (Process A) หาก ค่าอัตราการเกิดผลึกทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน รูปร่างของโครงสร้างขนาดนาโนเมตรที่ได้สุดท้ายจะมีรูป ร่างเหมือนหยดโลหะเริ่มด้นหรือควอนตัมดอต แต่ในกรณีที่อัตราการเกิดผลึกทั้งสองกรณีนี้แตกต่างกัน รูปร่างของโครงสร้างขนาดนาโนเมตรที่ได้สุดท้ายจะมีรูปร่างเป็นวงแหวนหรือโคนัท



(ก)

(1)

รูปที่ 2.11 แบบจำลองการแพร่ของ As ในหยุคโลหะ Ga (ก) และการเกิดผลึกในหยุคโลหะ Ga ภายใต้ไอของ As (ข) ในกระบวนการคริสตอลไลเซชัน [18]

สำหรับเทคนิคการประดิษฐ์ โครงสร้างขนาคนาโนเมตรด้วยเทคนิคครอปเพลทอิพิแทกซีได้ถูก ศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถในการประดิษฐ์ โครงสร้างขนาคนาโนเมตรจนสามารถประดิษฐ์ โครงสร้าง ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรายละเอียดไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้

2.4 สารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V

นับตั้งแต่ทศววรษที่ 50 ได้มีการก้นพบสารประกอบกึ่งตัวนำชนิดสองธาตุ (Binary) ของกลุ่ม III-V และคุณสมบัติต่างๆ ของสารประกอบเหล่านี้มีสมบัติทางกายภาพที่หลากหลายตามชนิดและองค์ประกอบ ของสารประกอบ นับตั้งแต่ก่าแถบพลังงาน (Band Energy Gap) ในช่วง 0.18-2.42 eV ก่าดัชนีหักเห ฯลฯ เป็นต้น ต่อมาในทศววรษที่ 60 ได้มีการพัฒนาวิธีการเตรียมของสารประกอบเหล่านี้เพื่อประยุกต์ใช้ใน การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และเทคนิกการปลูกผลึกต่างๆ ได้เริ่มด้นขึ้นในช่วงนี้ การปลูกผลึกอิพิแทกซี ในยุกนี้ส่วนใหญ่นั้นมีวัถตุประสงค์เพื่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ประมาณปี 1970 สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยว ข้องกับ GaAs เป็นสิ่งประดิษฐ์ของสารประกอบ III-V กลุ่มแรกที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น ในยุกนี้เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ในยุกต่อมา โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์สำหรับระบบสื่อสารทางแสงใน ช่วงย่าน 1.3 และ 1.5 μm ที่สร้างจากสารประกอบ InGaAsP บนแผ่นผลึกฐาน InP ดังนั้นในหัวข้อนี้จะ เป็นการทบทวนกวามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารประกอบกิ่งตัวนำกลุ่ม III-V

2.4.1 โครงสร้างของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V

สารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V มีโครงสร้างแบบ Zincblende ตามรูปที่ 2.12 ซึ่งมีลักษณะคล้าย กับโครงผลึกเพชร (Diamond) ได้แก่ ผลึกเพชร ผลึก Si และ ผลึก Ge โดยการเรียงตัวของอะตอมของ ธาตุหมู่ III และ V เรียงตัวสลับกันเป็นชั้นๆ ไปตามทิศทาง (100) ในโครงผลึก ซึ่งแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างอะตอมในโครงสร้างนี้เป็นแบบโควาเลนท์ (Covalent bond) เป็นส่วนใหญ่ และระยะห่าง ระหว่างอะตอมนั้นขึ้นกับชนิดของอะตอมที่มาประกอบกันเป็นสารประกอบในโครงผลึก ดังนั้นตัวแปร อีกตัวหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารประกอบแต่ละชนิดคือ ก่าดงตัวผลึก (Lattice constant : a) ซึ่ง สารประกอบแต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน ดังในตารางที่ 2.4



รูปที่ 2.12 แผนภาพโครงสร้างแบบ Zincblende

สารประกอบ	ค่าคงตัวผลึก (Å)	ค่าแถบพลังงาน (eV)	ชนิดของแถบพลังงาน
AlP	5.451	2.45	แถบพลังงานไม่ตรง
AlAs	5.6605	2.16	แถบพลังงานไม่ตรง
AlSb	6.1355	1.58	แถบพลังงานไม่ตรง
GaP	5.4512	2.26	แถบพลังงานไม่ตรง
GaAs	5.6533	1.42	แถบพลังงานตรง
GaSb	6.0959	0.72	แถบพลังงานตรง
InP	5.8686	1.35	แถบพลังงานตรง
InAs	6.0584	0.36	แถบพลังงานดรง
InSb	6.4794	0.17	แถบพลังงานตรง

ตารางที่ 2.4 ตัวแปรทางกายภาพของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ชนิค 2 ธาตุ [19]

2.3.2 สมบัติของสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V

เนื่องจากสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V นั้นมีคุณสมบัติที่หลากหลาย โดยขึ้นกับองค์ประกอบ และสัคส่วนปริมาณของธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นสารประกอบ ตามปกติแผ่นผลึกฐานเริ่มต้นส่วนใหญ่ นั้นเป็นสารประกอบกึ่งตัวนำชนิด 2 ธาตุ (Binary) ซึ่งมีสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัว เนื่องจากตัวแปร ขององค์ประกอบมีจำนวนน้อยที่สุด ทำให้ตัวแปรในการปลูกผลึกสามารถทำได้ง่าย ดังนั้นในการผลิต แผ่นผลึกฐานจึงนิยมทำจากสารประกอบ 2 ธาตุ แต่สมบัติที่จำกัดของสารประกอบชนิด 2 ธาตุที่ไม่เหมาะ สมสำหรับการใช้งานในบางกรณี กุญแจสำคัญคือสารประกอบชนิด 3 ธาตุและ 4 ธาตุได้ถูกนำมาใช้ใน การสร้างหัวต่อเฮเทอโร (Heterojunction) โดยมีก่าดงตัวผลึกเข้าได้กับแผ่นผลึกฐาน เนื่องจากค่าแถบ พลังงานหรือค่าดัชนีหักเหที่มีค่าแตกต่างกันไป อันเป็นผลทำให้มีความสะควกในการออกแบบสร้างสิ่ง ประกอบถึงตัวนำตัวอย่างดังในตารางที่ 2.4 และ 2.5

สารประกอบ	ค่าซ่องว่างแถบพลังงาน (eV) ที่ 300 K	ค่าช่องว่างแถบพลังงาน (eV) ที่ 300 K ในกรณีที่ Matching กับ InP
สารประกอบ 3 ธา	ମ୍	
Al _x In _{1-x} As	$E_g(\Gamma) = 0.36 + 2.35x + 0.24x^2$ $E_g(X) = 1.82 + 0.4x$	$E_g(\Gamma) = 1.45, x = 0.52$
Ga _x In _{1-x} As	$E_g(\Gamma) = 0.36 + 0.505x + 0.555x^2$	$E_g(\Gamma) = 0.75, x = 0.53$
GaAs _{1-x} Sb _x	$E_g(\Gamma) = 0.37 + 1.91x + 0.74x^2$	$E_g(\Gamma) = 0.78, x = 0.5$
สารประกอบ 4 ธา	9	
Ga _x In _{1-x} As _y P _{1-y}	$E_{g}(\Gamma) = 1.35 + 0.668x + 1.068y + 0.758x^{2}$ $+ 0.078y^{2} - 0.069xy + 0.322x^{2}y + 0.03xy^{2}$ $E_{o}(\Gamma) = 1.35 + 0.775y + 0.149x^{2}$	x = 0.47y $E_g(\Gamma) = 13.5 \cdot 0.775y + 0.149y^2$
Al _x Ga _y In _{1-x-y} As	$E_g(\Gamma) = 0.36 + 2.093x + 0.629y + 0.577x^2 + 0.436y^2 + 1.013xy - 2.0xy(1-x-y)$	$(In_{0.52}Al_{0.48})_{z}(In_{0.53}Ga_{0.47})_{1-z}As$ x = 0.48z, 0.983x+y = 0.468 $E_{g}(\Gamma) = 0.76 + 0.49z + 0.20z^{2}$

ตารางที่ 2.5 ค่าแถบพลังงานของตัวอย่างสารประกอบชนิค 3 ธาตุและ 4 ธาตุ [20]

บทที่ 3

การออกแบบการทดลอง

สำหรับในบทนี้เป็นรายละเอียดและขั้นตอนของกระบวนการทคลองในโครงงานวิจัยนี้ เพื่อทำการ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการประดิษฐ์โครงสร้างนาโนโฮลจาก In_{o.15}Ga_{o.85}As บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs (100) ด้วยวิธีครอปเพลทอิพิแทกซีที่ใช้การปลูกผลึกอิพิแทกซี จากลำโมเลกุล โดยตัวแปรในกระบวนการประดิษฐ์ที่ได้ศึกษาในโครงงานวิจัยนี้ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิแผ่น ผลึกขณะขึ้นรูปหยุดโลหะ ก่าช่วงเวลาการขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะ ก่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน และค่าเวลาในการคริสตอลไลเซชัน

3.1 การเตรียมแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น

แผ่นผลึกฐานในการทดลองนี้ใช้แผ่นผลึกเดี่ยว GaAs (100) เริ่มต้นจากการนำแผ่นผลึกฐานเริ่มมา ติดลง Mo Block ด้วย Indium หลอมเหลว หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นสู่อุณหภูมิห้องปกติ และนำ Mo Block ที่แผ่นผลึกฐาน GaAs เข้าสู่ระบบ MBE และทำการ Out-gassing ที่ 400 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงภาย ใต้สภาวะสุญญากาศ (<10⁻⁹ Torr) กระบวนการนี้กระทำภายใน Pre-heat chamber เพื่อทำความสะอาดผิว หน้าของแผ่นผลึกฐานเริ่มต้นด้วยความร้อนภายใต้สภาวะสุญญากาศ ต่อจากนั้นทำการลำเลียง Mo Block ที่ติดแผ่นผลึกฐาน GaAs ที่ผ่านกระบวนก Out-gassing เข้าสู่ Growth Chamber สำหรับกระบวนการภายใน Growth Chamber ในลำดับต่อมาทำการขจัดออกไซด์ที่ผิวแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs ที่อุณหภูมิ 600 °C ภายใต้บรรยากาศ As₄ จนผิวสะอาด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก RHEED pattern ที่ปรากฎขึ้นเป็นแบบ c(2X4) จากนั้นทำการปลูกชั้น Buffer ผลึก GaAs หนา 3000 Å ที่อุณหภูมิ 580 °C ด้วยก่าอัตราการปลูกผลึก 0.6 µm/ชั่วโมง และก่าอัตราส่วน Beam Equivalent Pressure (BEP) ของ As₄/Ga มีก่าประมาณ 30 โดยชั้น GaAs ที่ปลูกในขั้นตอนนี้เพื่อปรับคุณภาพกวามเรียบของผิวหน้าให้ดีขึ้น

3.2 การศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการประดิษฐ์โกรงสร้างนาโนโฮล In_{0.15}Ga_{0.85}As

หลังจากการปลูกผลึก GaAs ตามหัวข้อที่ 3.1 แล้วทำการลดอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานไปสู่ก่าอุณหภูมิที่ ได้กำหนดไว้ โดยไม่มีลำโมเลกุล As, เพื่อทำการลดปริมาณ As, ที่ผิวของแผ่นผลึกฐานให้มีก่าต่ำที่สุด (Minimize) จากนั้นรอจนก่าดวามดันภายใน Growth Chamber มีก่าดันบรรยากาศต่ำ 10⁻⁹ Torr เพื่อป้องกัน การเกิดปฏิกิริยาระหว่าง InGa และ As ในขณะขึ้นรูปหยุดโลหะ InGa สำหรับเงื่อนไขในการทดลองมีดังนี้

3.2.1 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุดโลหะ

สำหรับในการทดลองนี้ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหขดโลหะมีก่าดังนี้ 270, 300, 330, และ 360°C ตามลำดับ จากนั้นทำการขึ้นรูปหขดโลหะของ In_{0.15}Ga_{0.85} โดยมีก่าความหนา 20 ML ด้วยก่าอัตรา 1 ML/วินาที (ปริมาณของ In_{0.15}Ga_{0.85} และก่าอัตราการพ่นนี้เทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการปลูกผลึก In_{0.15}Ga_{0.85}As บน GaAs ในอัตรการปลูกผลึก 1 ML/วินาที) จากนั้นลดอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานลงไปที่ 210°C และทำการพ่นไอ As₄ ลงบนผิวหน้าของแผ่นผลึกฐาน เป็นเวลา 5 นาที เพื่อทำการเปลี่ยนหยดโลหะให้เป็น สารประกอบ III-V สุดท้ายทำการลดอุณหภูมิแผ่นผลึกลงและนำออกจากระบบ MBE เพื่อนำไปวิเคราะห์ ต่อไป

3.2.2 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะ

สำหรับในการทดลองนี้ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุดโลหะในการทดลองนี้มีค่า 300 ℃ ทำการขึ้นรูปหยุดโลหะของ In_{0.15}Ga_{0.85} โดยมีค่าความหนา 20 ML ด้วยอัตรา 1 ML/วินาที จากนั้นทำการ หยุดหลังจากการขึ้นรูปของหยุดโลหะเป็นเวลา 0, 2, 5, และ 7 นาที ต่อจากนั้นทำการลดอุณหภูมิแผ่นผลึก ฐานลงไปที่ 210℃ และทำการพ่น As₄ ลงบนแผ่นผลึกฐานเป็นเวลา 5 นาที เพื่อทำการเปลี่ยนหยุดโลหะ ให้เป็นสารประกอบ III-V สุดท้ายทำการลดอุณหภูมิแผ่นผลึกลงและนำออกจากระบบ MBE เพื่อนำ ไปวิเคราะห์ต่อไป

3.2.3 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิในการทำคริสตอลไลเซชัน

สำหรับในการทดลองนี้ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุดโลหะในการทดลองนี้มีค่า 360°C ทำการขึ้นรูปหยุดโลหะของ In_{0.15}Ga_{0.85} โดยมีก่ากวามหนา 20 ML ด้วยอัตรา 1 ML/วินาที จากนั้นทำการลด อุณหภูมิแผ่นผลึกฐานลงไปที่กำหนดดังนี้ 150, 180, 210, และ 240 °C และทำการพ่น As₄ ลงบนแผ่นผลึก ฐานเป็นเวลา 5 นาที เพื่อทำการเปลี่ยนหยุดโลหะให้เป็นสารประกอบ III-V สุดท้ายทำการลดอุณหภูมิแผ่น ผลึกลงและนำออกจากระบบ MBE เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

3.2.4 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการทำคริสตอลไลเซชัน

สำหรับในการทดลองนี้ล่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุดโลหะในการทดลองนี้มีค่า 360 ℃ ทำการขึ้นรูปหยุดโลหะของ In_{0.15}Ga_{0.85} โดยมีค่ากวามหนา 20 ML ด้วยอัตรา 1 ML/วินาที จากนั้นลด อุณหภูมิแผ่นผลึกฐานลงไปที่ 210 ℃ และทำการพ่น As, ลงบนแผ่นผลึกฐาน โดยระยะเวลาที่กำหนดมีดังนี้ 1, 2, 3, และ 5 นาที เพื่อทำการเปลี่ยนหยุดโลหะให้เป็นสารประกอบ III-V สุดท้ายทำการลดอุณหภูมิแผ่น ผลึกลงและนำออกจากระบบ MBE เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

สำหรับก่ากวามดันไอ BEP ของ As₄ ในกระบวนการเปลี่ยนรูปหยดโลหะธาตุหมู่ III ให้เป็นสาร ประกอบกลุ่ม III-V มีก่ากวามดันไอประมาณ 8 ×10° Torr

3.3 การวิเคราะห์ตัวอย่าง

ด้วอข่างที่ได้จากระบวนการประดิษฐ์นำมาวิเคราะห์ลักษณะผิวของด้วอข่างที่ได้ด้วย Atomic Force Microscope (AFM) ในการทำงานใน Tapping mode โดยผลที่ได้นี้แสดงไว้ในบทที่ 4

บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์

สำหรับในบททนี้นำเสนอผลการทดลองที่ได้จากการทดลองที่ได้ดำเนินการในโครงงานวิจัยนี้ ซึ่ง ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแปรหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ของโครงสร้างนาโนโฮล In_{o.is}Ga_{o.ss}As ที่ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคตรอปเพลทอิพิแทกซีโดยการใช้การปลูก ผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุล (MBE) ตัวแปรในโครงงานนี้ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูป หยดโลหะ เวลาการขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ ก่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานในการทำคริสตอลไลเซชัน และค่าเวลาในการทำคริสตอลไลเซชัน ซึ่งการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้ในโครงงานวินี้ใช้กล้องจุลทรรศน์ แรงอะตอมหรือ AFM

4.1 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยดโลหะ

ภาพด้วอย่างที่ได้จาก AFM ดังในรูปที่ 4.1 (ก) ซึ่งเป็นภาพผิวหน้าของนาโนโฮลของ In_{0.15}Ga_{0.85}As ที่ได้จากตัวอย่างที่ขึ้นรูปหยดโลหะที่ 300°C และใช้เวลาขัดจังหวะหรือช่วงเวลาหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ ก่อนการลดอุณหภูมิลงค่าสำหรับการคริสตอลไลเซชันเป็นเวลา 2 นาที ก่อนทำการลดอุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน ไปสู่ค่าอุณหภูมิ 210°C เพื่อทำการคริสตอลไลเซชันด้วยการพ่นไอของ As₄ โดยภาคตัดขวางของตัวอย่างนี้ ดังในรูปที่ 4.1 (ข) ค่าความกว้าง (*s*) ความลึก (*d*) และความสูงสันขอบวงแหวน (*h*) ของโครงสร้างนาโนโฮล จากรูปดังกล่าวมีค่าความกว้าง *s* = 123 nm ในแนว [110] และมีค่าความกว้าง *s* = 133.5 nm ในแนว [110] ก่าความลึก *d* = 3.7 nm และมีค่าความหนาแน่น 6.2 ×10[°] cm⁻² สำหรับรูปร่างของนาโนโฮลมีรูปร่างคล้ายตัว



รูปที่ 4.1 (ก) ภาพ AFM ของนาโนโฮลจาก In_{0.15}Ga_{0.85}As บน GaAs (ข) ภาพตัดขวางของตัวอย่างในกรอบเส้นประจากรูป (ก)



รูปที่ 4.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นของนาโนโฮล (ก) และค่าเฉลี่ยความกว้างระหว่าง สันขอบวงแหวน (ข) ในฟังก์ชันของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะที่ขึ้นรูปหยุดโลหะ

อักษร U (U-shape) ในแนว [110] และมีรูปร่างกล้ายด้วอักษร W (W-shape) ในแนว [110] โดยความแตก ต่างของรูปร่างในแนว [110] และ [110] นี้เกิดจากคุณสมบัติแอนไอโซโทรปิก (Anisotropic) ของผลึกที่เกิด ขึ้นในกระบวนการกริสตอลไลเซชัน และค่าเฉลี่ยความสูงของสันขอบวงแหวน *k* = 1.9 nm ในแนว [110] และ *k* = 5.7 nm ในแนว [110] จากมุมมองค้านบน (Top-view) โกรงสร้างนาโนโฮลมีรูปลักษณะเป็นหลุม รูปร่างกล้ายสี่เหลี่ยมที่มีวงแหวนที่ล้อมรอบ (Ring-and-hole) สำหรับความลึกของนาโนโฮลในแนว [110] และ [110] มีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากคุณสมบัติแอนไอโซโทรปิคของผลึกที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำการกริส ตอลไลเซชัน สำหรับอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกขณะขึ้นรูปหยุคโลหะที่มีต่อโครงสร้างนาโนโฮล เมื่อพิจารณาค่าขนาคของโครงสร้าง ได้แก่ ค่ากวามกว้าง (s) ในแนว [110] ซึ่งมีก่าความกว้างเฉลี่ย 89 nm สำหรับตัวอย่างที่ใช้อุณหภูมิ 270 °C, 124 nm สำหรับตัวอย่างที่ใช้อุณหภูมิ 300°C, 112 nm สำหรับตัวอย่าง ที่มีค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน 330°C, และ 119 nm จากตัวอย่างที่ใช้อุณหภูมิ 300°C, 112 nm สำหรับตัวอย่าง สำหรับค่าความลึกเฉลี่ยที่ได้นี้มีค่าน้อยกว่า 20 Monolayer ของ (~5.6 nm) In_{0.15}Ga_{0.85}As สำหรับค่าความ หนาแน่นนาโนโฮลมีก่าลดลง แต่ก่าเฉลี่ยความกว้างระหว่างสันขอบของวงแหวนดังในรูปที่ 4.2 โดยก่าความ หนาแน่นนาโนโฮลมีก่าลดลง แต่ก่าเฉลี่ยกระบวนกว้างระหว่างสันขอบของวงแหวนมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อก่า อุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยุดโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น

4.2 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะขึ้นรูปหยดโลหะ

สำหรับอิทธิพลช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะสามารถแสดงด้วยลักษณะการกระจาย ประชากรของตัวอย่างจากค่าเฉลี่ยความลึกจากผลของช่วงเวลาขัดจังหวะดังในรูปที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยความลึกของ





นาโนโฮอมีดังนี้ จากตัวอย่างที่ไม่มีช่วงเวอาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ (0 นาที) มีค่าเฉลี่ยความลึก 4.8 nm ตัวอย่างที่มีช่วงเวอาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ 2 นาทีมีค่าเฉลี่ยความลึก 4.4 nm ตัวอย่าง ที่มีช่วงเวอาขัดหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ 5 นาทีมีก่าเฉลี่ยความลึก 4.9 nm และตัวอย่างที่มีช่วงเวลาขัด จังหวะหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ 7 นาทีมีก่าเฉลี่ยความลึก 4.9 nm สำหรับก่าความกว้าง (s) ในแนว [110] จากตัวอย่างที่มีช่วงเวลาหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ 0 นาที มีก่ากว้าง 95 nm จากตัวอย่างที่มีช่วงเวลาหลังการ ขึ้นรูปหยดโลหะ 2 นาทีมีก่าเฉลี่ยความกว้าง 124 nm จากตัวอย่างที่มีช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยด โลหะ 5 นาทีมีก่ากว้าง 108 nm และจากตัวอย่างที่มีช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ 7 นาที มีก่าเฉลี่ยความกว้าง 108 nm และจากตัวอย่างที่มีช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ 7 นาที มีก่าเฉลี่ยความกว้าง 100 nm เมื่อพิจารณาจากซีสโตแกรมการกระจายของประชากรตัวอย่างในเทอมของ ความลึกจากรูปที่ 4.3 นั้น ก่าความสม่ำเสมอนั้นจะมีก่าดีที่สุดที่ช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยดโลหะ 7 นาที เนื่องจากการเคลื่อนที่ของหยดโลหะและการรวมตัวของหยดโลหะมีผลทำให้การกัดเซาะที่ทำให้ เกิดนาโนโฮลมีการกระจายความลึกที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งหยดโลหะที่เคลื่อนท่ใปนั้นได้มีการดูดกลืน As จากผิวของแผ่นผลึกฐาน ทำให้ชีดกวามสามารถในการก็ดเซาะลดลงอีกด้วย ดังนั้นเราจึงเห็นประชากร



รูปที่ 4.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นของนาโนโฮล (ก) และค่าเฉลี่ยความกว้าง ในแนว [110] (ข) ในฟังก์ชันของค่าช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะ

ของตัวอย่างที่มีก่ากวามถึกน้อยปรากฎให้เห็นในตัวอย่างที่ช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะ 2 และ 10 นาที ซึ่งเป็นโฮลที่ได้จากการกัดขึ้นใหม่จากหยุดโลหะหลอมเหลวที่เกลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

สำหรับค่าความหนาแน่นนาโนโฮลและค่าเฉลี่ยความกว้างในฟังก์ชันของค่าช่วงเวลาขัดจังหวะหลัง การขึ้นรูปหยุดโลหะดังในรูปที่ 4 โดยผลที่ได้จากการทดลองศึกษาอิทธิพลของค่าช่วงเวลาขัดจังหวะหลัง การขึ้นรูปหยุคโลหะดังในรูปที่ 4 (ก) นั้นสามารถอธิบายผลการทุดลองที่ได้ด้วยแบบจำลองแบบง่ายดังนี้ ใน สภาวะเริ่มแรกที่ไม่มี As, นั้น หลังจากการขึ้นรูปหยุดโลหะของ In_{o.15}Ga_{o.85} หยุดโลหะนั้นมีสภาพเป็นของ เหลว เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาวะสมคุล คังนั้นระบบจำเป็นต้องปรับตัวเองให้มีพลังงานต่ำที่สุด หยุดโลหะที่ ผิวจะดูดซับ As จากแผ่นผลึกฐานด้วยกระบวนการแพร่ (Diffusion) และการกัดเซาะ (Soaking) โดยทำให้ หยุดโลหะเปลี่ยนรูปเป็นสารละลาย In-Ga-As เมื่อเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่งหยุดโลหะจำนวนหนึ่งมีการ เคลื่อนที่และรวมตัวกันกลายเป็นหยุคโลหะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อทำให้พลังงานระบบมีค่าลุคลง ในปรากฏ การณ์นี้ทำให้ก่าความหนาแน่นของจำนวนหยุดโลหะมีก่าลดลง ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าในช่วง เวลา 0-2 มาที่นั้นหลังจากทำการพ่น As, ในทำการคริสตอลไลเซชัน ค่าความหนาแน่นของนาโนโฮลที่ได้ ้มีก่าลดลงเมื่อช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะมีระยะเวลานานขึ้น เนื่องจากจำนวนของนาโน โฮลที่ได้สอดกล้องกับจำนวนของหยุดโลหะ ในกรณีนี้นาโนโฮลที่เกิดขึ้นจะมีก่าความหนาแน่นเท่ากับก่า ความหนาแน่นของหยุดโลหะ และช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะในกรณีไม่นานเพียงพอที่ ทำให้เกิดนาโนโฮลด้วยกระบวนการกัดขึ้นรูป (Etching) ที่ผิวหน้าของแผ่นผลึกฐาน หยุดโลหะจะเคลื่อนที่ และรวมตัวกันทำให้จำนวนค่าความหนาแน่นที่ได้มีค่าลดลง แต่เมื่อช่วงเวลาขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหย ดโลหะนานขึ้น จำนวนของนาโนโฮลมีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น อันเกิดขึ้นเนื่องจากเวลาที่นานขึ้นทำให้ เกิดนาโนโฮลขึ้นจากกระบวนการกัดขึ้นรูป และกระบวนการเปลี่ยนรูปนาโนโฮลในกระบวนการคริส ตอลไลเซชันที่ทำให้ของหยุดโลหะกลายเป็นสารประกอบกลุ่ม III-V อันเป็นผลให้ก่ากวามหนาแน่นของ นาโนโฮลที่ได้มีก่าเพิ่มขึ้น จากสาเหตุที่ผิวรอยต่อระหว่างแผ่นผลึกฐาน และหยุดโลหะมีสภาพเป็นของเหลว In-Ga-rich ดังนั้นบริเวณรอยต่อนี้แผ่นผลึกฐาน GaAs ถูกละลายค้วยโลหะหลอมเหลว In-Ga ทำให้หยด โลหะเปลี่ยนสภาพเป็นสารละลายเป็น In-Ga-As เนื่องจากอะตอม As จากแผ่นผลึกฐานแพร่จากแผ่นผลึก ฐานเข้าสู่หยุดโลหะ In-Ga และเปลี่ยน In-Ga กลายเป็น In-Ga-As ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ทำให้หยุดโลหะ บางส่วนกลายเป็นผลึก InGaAs โดยเฉพาะที่บริเวณขอบด้านข้างของหยุดโลหะกลายเป็นผลึกก่อน [18] อันทำให้เกิดเป็นผลึก InGaAs รูปวงแหวนขึ้นที่ขอบด้านข้างภายในหยุดโลหะ เมื่อเวลาผ่านไปนานสมควร สารละลายของโลหะหลอมเหลว In-Ga-As ทำให้เกิดกัดขึ้นจนกลายเป็นโฮลหรือหลุมใต้สารละลายหยด โลหะ กระบวนการเกิดโฮลและวงแหวนที่ล้อมหลุมเกิดขึ้นไปพร้อมกัน แต่เนื่องจากปริมาณของ As ที่ได้ จากกระบวนการกัดมีค่าไม่เพียงพอที่จะทำให้หยุดโลหะทั้งหมุดกลายเป็นผลึก In-Ga-As ดังนั้นหยุดโลหะ บางส่วนที่ยังเป็นของเหลวสามารถเคลื่อนที่ได้ จึงเกิดการเกลื่อนที่และรวมตัวกับหยดโลหะอื่น ก่อนตัว ขึ้นใหม่กลายเป็นหยุดโลหะหยุดใหม่ ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผลลัทธ์ที่ได้จำนวนของ นาโนโฮลมีค่าความหนาแน่นมากขึ้นจากกระบวนการกัดเซาะของหยุคโลหะ และการเคลื่อนย้ายของหยุค โลหะ และเมื่อทำการพ่น As4 เพื่อทำการ Crystallization กระบวนการต่างๆ จะสิ้นสุดลง ด้วยเงื่อนไขค่า ควาดันไอของ As, ที่มีค่าต่ำทำให้หยด โลหะเปลี่ยนรูปเป็นนาโนโฮล ดังนั้นค่าความหนาแน่นของนาโน โฮลมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อค่าช่วงเวลาหลังการขึ้นรูปโลหะมีค่ามากขึ้น เมื่อทำการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยขนาคของ นาโนโฮลในช่วงเวลา 0-2 นาที่ขนาดของนาโนโฮลที่ขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งสอคกล้องตามสมมติฐานในแบบ จำลองของการรวมตัวของหยุดโลหะและค่าความหนาแน่นลดค่าลง แต่เมื่อเวลานานกว่า 2 นาที่ค่าความ หนาแน่นของนาโนโฮลมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลไกการเกิดนาโนโฮลเกิดจากกระบวนการกัดของหยด โลหะและนาโนโฮลที่เกิดขึ้นในกระบวนคริสตอลไลเซชันและค่าเฉลี่ยของขนาคมีค่าลคลง เนื่องจาก ปริมาณของหยุดโลหะที่สูญเสียไปในกระบวนการกลายเป็นผลึก InGaAs ในกระบวนการกัดขึ้นรูปก่อน กระบวนการคริสตอล ไลเซชัน ข้อสังเกตุจากผลการทคลองนี้ค่าขนาดของนาโนโฮลจะมีจำนวนหนึ่งที่มี ขนาดใหญ่ขึ้นจากลักษณะการกระจายในรูปที่ 4.3 เวลานานหลังช่วงการขึ้นรูปหยุดโลหะมีระยะเวลานาน ขึ้น แต่จำนวนของนาโนโฮลขนาดใหญ่มีจำนวนลคลง เมื่อเวลานานหลังช่วงการขึ้นรูปหยุดโลหะมีระยะ เวลานานขึ้น ซึ่งผลที่ได้ในการทดลองนี้สอดกล้องกันกับกรณีของ Ga บนแผ่นผลึกฐาน GaAs (100) และ กลไกที่เกิดขึ้นได้อธิบายไว้เอกสารอ้างอิง [21-22]

4.3 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าอุณหภูมิในการคริสตอลไลเซชัน

สำหรับการทคลองในการศึกษาอิทธิพลของก่าอุณหภูมิในการคริสตอลไลเซชันนั้น ปรากฏว่า ตัวอย่างที่ได้จากการทำคริสตอลไลเซชันที่อุณหภูมิ 170 และ 200°C นั้น ตัวอย่างที่ได้เป็นรูปวงแหวนนาโน ที่ล้มรอบนาโนโฮล แต่เมื่อทำคริสตอลไลเซชันที่อุณหภูมิ 230 และ 260°C ตัวอย่างที่ได้มีนั้นมีโครงสร้าง ขนาดนาโนเมตร 2 ลักษณะเกิดขึ้นคือ รูปร่างวงแหวนนาโนที่ล้อมรอบนาโนโฮล และรูปร่างวงแหวนล้อม รอบควอนตัมคอต ดังในรูปที่ 4.5 และภาคตัดขวางดังในรูปที่ 4.6 ซึ่งกลไกการเปลี่ยนรูปจากวงแหวนที่ ล้อมรอบนาโนโฮลนั้นเกิดขึ้นบางส่วนเฉพาะเงื่อนไขการคริสตอลไลเซชันที่อุณหภูมิตั้งแต่ 230°C เป็นต้น ไป โดยการคริสตอลไลเซชันที่อุณหภูมิสูงขึ้นมีผลทำให้ความสามารถในการแพร่ของ As ในหยดโลหะ หลอมละลายเกิดได้ดีขึ้นกว่าในกรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นค่าความหนาแน่น ของวงแหวนล้อมรอบนาโนโฮลจะมีค่าลดลง และค่าความหนาแน่นวงแหวนล้อมรอบควอนตัมคอตมี ถ่าเพิ่มขึ้น แต่ผลรวมของค่าความหนาแน่นกลับมีค่าลดลง เมื่อค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานในการทำคริส ตอลไลเซชันมีค่าเพิ่มขึ้นโดยปรากฏการณ์นี้สามารถอธิบายได้จากการเคลื่อนที่ของหยุดโลหะ และที่รวมกัน







รูปที่ 6 ภาพภาคตัดขวางผ่าน AFM ของนาโนโฮลจาก In_{0.15}Ga_{0.85}As บน GaAs จากตัวอย่างที่ทำการคริสตอลไลเซชันที่อุณหภูมิ (ก) 200°C (ข) 260°C

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทคลองการศึกษาอิทธิพลของก่าอุณหภูมิในการคริสตอลไลเซชัน ในเทอมของตัวแปรขนาคจากนาโนโฮลที่ได้

ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐาน ในขณะทำ การคริสตอลไลเซชัน (°C)	ี่คำความหนาแน่น (cm ^{⁻2})	ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง ที่ฐานรอบนอก (nm) ในแนว [110]	ค่าความสูง ของสันขอบ (nm)
170	1.6×10 ⁹	134.8	3.9
200	1.2×10 ⁹	133.6	3.3
230	9.4 ×10 ⁸ /1.1 ×10 ⁸	137.8/133.4	4.1/7.3
260	$7.2 \times 10^8 / 1.4 \times 10^8$	144.6/150.0	3.5/12.6

หมายเหตุ ที่อุณหภูมิ 230 และ 270 °C ก่ากวามหนาแน่น ก่าเฉลี่ยเส้นผ่าสูนย์กลางและก่ากวามสูงของ สันเป็นก่าของ วงแหวนล้อมรอบนาโนโฮล/วงแหวนล้อมรอบกวอนตัมคอต

กันในกรณที่อุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นด่ามิติต่างๆ จึงมีก่าเพิ่มขึ้นตามขนาดหยุดโลหะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจาก การรวมตัวของหยุดโลหะ

4.4 การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าเวลาในการคริสตอลไลเซชัน

สำหรับผลการทดลองในการศึกษาอิทธิพลของค่าเวลาในการคริสตอลไลเซชันนั้นผลที่ได้จาก โครงสร้างนาโนโฮลนั้นไม่ชัดเจนทางกายภาพ ซึ่งค่าขนาดของส่วนต่างๆ มีก่าใกล้เคียงกันหรือแตกต่าง กันเล็กน้อย ซึ่งสันนิฐานได้จากก่าตัวแปรในการประดิษฐ์ในการทดลองนี้กลาดเกลื่อนไป ทำให้ผลที่ได้ นั้นความแตกต่างกัน ดังผลสรุปในตารางที่ 4.2

ในเทอมของตัวแปรขนาคจากนาโนโฮลที่ได้					
ค่าเวลาการคริสตอลไลเซชัน (นาที)	ด่าความหนาแน่น (cm ⁻²)	ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าสูนย์กลาง ที่ฐานรอบนอก (nm)	ี่ ก่ากวามสูง ของสันขอบ (nm)		
2.5	1.0×10 ⁹	147.8	4.3		
5	1.2×10 ⁹	133.6	3.3		
7.5	9.3×10^{8}	138.3	4.1		

ตารางที่ 4.2 สรุปผลการทคลองการศึกษาอิทธิพลของค่าเวลาในการครีสตอลไลเซชัน

135

4.2

 1.2×10^{9}

10

บทที่ 5

ตัวอย่างการประยุกต์

สำหรับในบทนี้เป็นการสาธิตการนำโครงสร้างนาโนโฮลไปประยุกต์ใช้งานในกระบวนการ ประดิษฐ์กวอนตัมโมเลกุลที่มีเรียงตัวเกาะกันทางด้านข้าง (Lateral Quantum Molecule) โดยหน้าที่ของ โครงสร้างนาโนโฮลในกระบวนการประดิษฐ์นั้นเป็นเทมเพลท (Template) เพื่อรองรับควอนตัมดอตให้เกาะ กลุ่มกันเป็นควอนตัมดอตโมเลกุล สนามความเครียดที่เกิดขึ้นในนาโนโฮลจะเหนี่ยวนำให้ควอนตัมดอต ที่ปลูกขึ้นใหม่นี้เกาะตัวบนเทมเพลทดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป

5.1 วิธีการประดิษฐ์

ในการทคลองนี้เริ่มด้นจากแผ่นผลึกฐาน GaAs (100) ชนิคกึ่งฉนวน โดยมีการเตรียมแผ่นผลึก ตามกระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.1 ซึ่งขั้นตอนกระบวนการประดิษฐ์กวอนตัมคอตโมเลกุลแบ่ง ออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

(ก) การประดิษฐ์นาโนโฮล : ทำการปลูกผลึกชั้น Buffer ของ GaAs หนา 300 nm ที่อุณหภูมิแผ่น ผลึกฐาน 600°C ด้วยอัตราการปลูกผลึก 0.5 ML/วินาที โดยมีค่าอัตราส่วน BEP As₄/Ga 30 เท่า จากนั้นทำ การลดอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานลงที่ 390°C โดยไม่มีลำโมเลกุลของ As₄ และรอจนกระทั่งค่าความดัน บรรยากาศมีค่าต่ำกว่า 10⁻⁹ Torr ทำการขึ้นรูปหยุดโลหะ In_{0.15}Ga_{0.85} ในปริมาณ 20 ML (ปริมาณนี้เทียบเท่า กับปริมาณของ In และ Ga ที่ใช้ในการปลูกผลึก In_{0.15}Ga_{0.85}As หนา 20 ML) ด้วยอัตราการพ่น 1 ML/วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานลงมาที่ 390°C และทำการคริสตอลไลเซชันด้วยการพ่นด้วยไอของ As₄ ที่ มีก่าความดันไอ 8X10⁻⁶ Torr เพื่อเปลี่ยนรูปหยุดโลหะ InGa ให้เป็น InGaAs

(ข) การประคิษฐ์ควอนตัมคอต โมเลกุล : จากนั้นทำการเพิ่มค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานไปที่ 450°C และทำการปลูกผลึกควอนตัมคอต InAs ในปริมาณ 1.7 ML ด้วยค่าอัตราการปลูกผลึก 0.05 ML/วินาที

สำหรับการวิเคราะห์กระบวนการประดีษฐ์กวอนตัมดอดโมเลกุลในที่นี้ จะทำตรวจสอบตัวอย่าง นาโนโฮลก่อนการปลูกควอนตัมดอดที่อุณหภูมิปลูกควอนตัมดอด และควอนตัมดอดโมเลกุลด้วยกล้อง จุลทรรศน์แรงอะตอมหรือ AFM

5.2 ผลการทดลองและการวิเคราะห์

สำหรับตัวอย่างที่ได้จากการสาธิตนี้ได้เทมเพลทของนาโนโฮลมีก่าดวามหนาแน่น 4.8X10⁸ ซม⁻² และภาพ AFM และภาพภาคตัดขวางดังในรูปที่ 5.1 (ก) โดยก่าเฉลี่ยเส้นผ่าสูนย์กลางที่ฐานรอบนอก 230 nm



รูปที่ 5.1 ภาพ AFM แบบ 2 มิติ 3 มิติ และภาพภาคตัดขวางของ (ก) นาโนโฮล (ข) นาโนโฮลที่ เปลี่ยนรูปไปหลังการเพิ่มอุณหภูมิ และ (ก) ควอนตัมคอตโมเลกุลชนิด 4 คอต

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน 82 nm และค่าเฉลี่ยความสูงของวงแหวน 3.5 nm ในแนว [110] และเมื่อทำ การเพิ่มอุณหภูมิแผ่นผลึกขึ้นไปที่ 450°C ด้วอย่างนาโนโฮลเกิดการเปลี่ยนรูปมีลักษณะคล้ายเนิน (Mound) ดังในรูปที่ 5.1 (ข) โดยมีค่าเฉลี่ยความยาวของฐาน 180 nm ในแนว [110] และมีค่าเฉลี่ยความยาวของฐาน 270 nm [110] และค่าเฉลี่ยความสูงของเนิน 7.7 nm สาเหตุค่าเฉลี่ยความยาวของฐานแตกต่างกันในแต่ละ แนวนั้น อันเนื่องจากคุณสมบัติแอนไซโทรปิก (Ansitropic) ของผลึก และด้วอย่างควอนตัมดอตโมเลกุล แบบ 4 ดอตคังในรูปที่ 5.1 (ก) ซึ่งขนาดของควอนตัมดอตที่ได้มีขนาดแตกต่างกัน เนื่องจากความสม่ำเสมอ ของสนามความเครียดของเนินที่ได้จากนาโนโฮลมีความไม่สมมาตรในแนว [110] และ [110] ถึงทำ ให้ควอนตัมดอตที่ได้มีขนาดแตกต่างกัน

สำหรับตัวอย่างกวอนตัมคอตโมเลกุลที่ได้จากตัวอย่างนี้มีจำนวนควอนตัมคอตในควอนตัมคอต โมเลกุลที่ได้มีจำนวน 2, 3 ,และ 4 คอต ดังในรูปที่ 5.2 สาเหตุเนื่องจากพื้นที่และสนามความเครียดของ เนินที่ได้จากการเปลี่ยนรูปของนาโนโฮลในกรณีมีความไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ก่าอัตราการปลูกผลึก ของควอนตัมคอตที่ใช้ในกรณีมีก่าสูงอีกด้วย จึงทำให้ขนาดของควอนตัมที่ได้มีไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นใน ตัวอย่างที่ได้ในการสาธิตนี้



รูปที่ 5.2 ภาพ AFM แบบ 3 มิติของควอนตัมดอต โมเลกุล ชนิด (ก) 2 ดอต (ข) 3 ดอต และ (ก) 4 ดอต

สำหรับความสม่ำเสมอของจำนวนควอนตัมดอตในควอนตัมคอตที่ได้จากการสาธิตมีลักษณะการ กระจายคังในรูปที่ 5.3 โดยจำนวนประชากรของควอนตัมดอตโมเลกุลชนิด 3 ดอตมีมากที่สุดคือ 46% สำหรับควอนตัมดอตโมเลกุลชนิด 4 ดอตมีจำนวนประชากร 42 % และควอนตัมดอตโมเลกุลชนิด 2 ดอตมี จำนวนประชากร 12% สาเหตุที่ทำให้ควอนตัมดอตโมเลกุลมีจำนวนควอนตัมดอตแตกต่างในที่นี้เกิด จากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความสม่ำเสมอของนาโนโฮลเริ่มต้น อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิในการ เปลี่ยนรูปนาโนโฮลเป็นเนิน ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำการปลูกควอนตัมดอต ค่าอัตราการปลูกผลึก สำหรับควอนตัมดอต และปริมาณของผลึกควอนตัมดอตที่ปลูก ฯลฯ เป็นต้น

ในการสาธิตนี้ได้แสดงความเป็นไปได้ในการนำนาโนโฮลมาใช้เป็นเทมเพลทในกระบวนการ ประดิษฐ์ควอนตัมคอตโมเลกุล ซึ่งเงื่อนไขที่เหมาะสมนั้นยังต้องการการศึกษาและพัฒนาต่อไป



รูปที่ 5.3 กราฟแสดงการกระจายของจำนวนประชากรของกวอนตัมดอต โมเลกุล ที่มีจำนวนกวอนตัมดอต 2 ดอต 3 ดอต และ 4 ดอตในแต่ละ โมเลกุล

้โครงงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของเงื่อนไขหรือตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประดิษฐ์นาโนโฮล In_{0.15}Ga_{0.85}As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs (100) ด้วยเทคนิคครอปเพลทอิพิแทกซีที่ใช้วิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซี จากลำโมเลกุล โดยตัวแปรที่ได้ทำการศึกษาในโครงงานวิจัยนี้ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำ การขึ้นรูปหยุดโลหะ ค่าช่วงเวลาการขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะ ค่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะ ทำกริสตอลไลเซชัน และก่าช่วงเวลาในการทำกริสตอลไลเซชัน โดยรูปร่างของนาโนโฮลที่ได้นั้นมีก่า ้ขนาดในแนว [110] และ [110] แตกต่างกัน เนื่องจากคุณสมบัติแอนไอโซโทรปีคของผลึกที่เกิดขึ้นแนว [110] และ [110] นั้นแตกต่างกัน ซึ่งความหนาแน่นของนาโฮลที่ได้มีอยู่ในช่วง 6×10⁸ -1.8 ×10² ซม² และ มีก่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของสันขอบวงแหวนอยู่ในช่วง 90-120 nm โดยก่ากวามหนาแน่นลดลง แต่ก่า มิติของนาโนโฮลมีขนาดเพิ่มใหญ่ เมื่อก่าแผ่นผลึกฐานขณะทำการขึ้นรูปหยุดโลหะมีก่าเพิ่มขึ้น สำหรับ ช่วงเวลาการขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะนั้นมีผลต่อก่าความหนาแน่นของนาโนโฮลที่ได้ โดยแบ่ง ออกเป็น 2 กรณีคือกรณีที่ช่วงเวลาสั้นไม่เพียงพอทำให้เกิดการกัดเซาะแผ่นผลึกฐาน หยุดโลหะบางส่วน สามารถเคลื่อนที่ได้บนผิวของแผ่นผลึกฐานและเกิดการรวมตัวของหยุดโลหะ ซึ่งในกรณีนี้ก่ากวามหนา แน่นที่ได้มีก่าลคลงจากก่าเริ่มต้น และในอีกกรณีที่ช่วงเวลาเพียงพอที่ทำให้เกิดการกัดเซาะแผ่นผลึกฐานได้ หยุดโลหะส่วนที่กัดเซาะแผ่นผลึกฐานแล้วได้เกลื่อนที่จากดำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่และทำให้เกิด การกัดเซาะ ซึ่งหยุดโลหะที่เคลื่อนที่ไปนั้นอาจรวมตัวกับหยุดโลหะอื่นก็ได้และจากนั้นทำการกัดเซาะผิว หน้าแผ่นผลึกฐาน ผลจากการเกลื่อนที่ของหยุดโลหะและการกัดเซาะเป็นผลทำให้ความสม่ำเสมอของ นาโนโฮลที่ได้อย่างเด่นชัด โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานมีค่าลดลง เพียงพอที่ให้ปรากฏการณ์ลคลงหรือยุติลงก็ได้ ซึ่งผลจากปรากฏการณ์นี้ทำให้ค่าความหนาแน่นนาโนโฮลที่ ้ได้มีก่าเพิ่มขึ้นเมื่อก่าช่วงเวลาการขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะมีก่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จากก่าช่วงเวลา การขัดจังหวะหลังการขึ้นรูปหยุดโลหะนั้นมีผลต่อค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสันขอบวงแหวนโดย แปรผกผันตามก่าความหนาแน่น สำหรับก่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำกริสตอลไลเซชันนั้นมีผลต่อ รูปร่างสุดท้ายของนาโนโฮลอย่างเค่นชัด โคยก่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานขณะทำกริสตอลไลเซชันที่ต่ำกว่า 230°C โครงสร้างนาโนที่มีลักษณะเป็นวงแหวนล้อมรอบนาโนโฮล แต่เมื่อค่าอณหภูมิแผ่นผลึกฐาน ขณะทำคริสตอลไลเซชันตั้งแต่ 230°C เป็นต้นไป โครงสร้างขนาดนาโนเมตรที่ได้บางส่วนมีลักษณะเป็น ้วงแหวนล้อมรอบควอนตัมดอต แต่ผลของค่าช่วงเวลาในการทำคริสตอลไลเซชันนั้นมีผลต่อค่าความหนา แน่นและค่าขนาคมิติอย่างไม่เด่นชัด

บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ

สำหรับโครงการวิจัยนี้ก่าอุณหภูมิแผ่นผลึกฐานที่ใช้เป็นก่าอุณหภูมิผิวหน้าของแผ่นผลึกฐานที่ได้ จากการเปรียบเทียบกับค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากรูปแบบ RHEED ที่จุดเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งมีความ คลาคเกลื่อนมากกว่า 10°C ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือการใช้ IR Pyrometer แต่เครื่องมือนี้มีราคาแพง สำหรับ อีกวิธีการหนึ่ง ได้แก่ การใช้โลหะหรือวัสดุที่มีค่าอุณหภูมิจุดหลอมเหลวในช่วงที่เราทำงาน เช่น AI มีค่า อุณหภูมิจุดหลอมเหลวที่ 660°C หรือ InSb มีค่าอุณหภูมิจุดหลอมเหลวที่ 525°C ติดไว้บนผิวหน้าแผ่น ผลึกฐาน และทำการเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่อ่านได้จาก Pyrometer และก่าที่ได้จากเทอร์โมคัปเปอร์ เพื่อ ให้เราสามารกำหนดค่าอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น แต่วิธีการนี้ยุ่งยากและไม่เหมาะสมสำหรับการทำงาน ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากได้ หากใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้การ ผลิตสามารถทำซ้ำได้อย่างน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังนี้ส่วนที่ขาดในโครงงานวิจัยนี้คือการตรวจสอบ คุณสมบัติของโครงผลึกที่ได้ด้วย X-Ray ซึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้คือ Double Crystal X-Ray Diffraction เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถหาเครื่องมือนี้ได้ และเครื่องมือนี้เป็นเครื่องหลักของการวิจัยด้านวัสดุ และสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าคงผลึก (Lattice constant) โดยเครื่องมือสามารถบอก ้ ค่าคงตัวผลึกและค่าความแตกต่างของค่าคงตัวผลึกที่ปลูกขึ้นบนแผ่นผลึกฐาน และผลการทคลองที่ได้จาก เทคนิคครอปเพลทอิพิแทกซีของวิจัยนี้ไม่สามารถตรวสอบสภาพความได้สัดส่วนของสารประกอบของผลึก ที่ได้ รวมถึงองค์ประกอบทางเคมี ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ Focus Ion Beam (FIB) และ Secondary Ion Mass Spectrometer (SIMS) มีราคาแพงและไม่สามารถหาใช้บริการในประเทศไทยใน การวิเกราะห์คุณภาพผลึกที่ได้ ผู้วิจัยหวังไว้ว่าจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในโครงการวิจัยอื่นๆ ที่ ต่อเนื่องจากโครงการวิจัยนี้ต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

- A. Imamoglu, D.D. Awschalom, G. Burkard. D.P. DiVincenzo, D. Loss, M. Sherwin, A. Small, Phys. Rev. Lett 83, 4204 (1999).
- 2. A. Lorke, R. J. Luyken, A.O. Govorovm, J.P. Kottaus, Phys. Rev. Lett. 84, 2223 (2000).
- D. Leonard, M. Krisnamurthy, C. Reaves, S.P. Denbaars, and S.M. Petroff, Appl. Phys. Lett. 63, 3203 (1993).
- 4. Rudeesun Songmaung, Suwit Kiravittaya, and Oliver G. Schmidt, Appl. Phys. Lett 82, 2892 (2003).
- Ziad Y. AbuWaar, Yariy I. Mazur, Jihoon H. Lee, Zhiming M. Wang, and Gregory J. Salamo, J. Appl. Phys. 101, 024311 (2007).
- 6. T. Mano, N. Koguchi, J. Crystal Growth 278, 108 (2005).
- Tsunenori SAKAMOTO, Hideo FUNABASHI, Kimihiro OHTA, Tadashi NAKAGAWA, Naoyuki KAWAI, and Takeshi KOJIMA, "Phase-Locked epitaxy using RHEED Intensity Oscillation", Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 23, No. 9, 1984, pp. L657-L659.
- Yoshiji HORIKOSHI, Minoru KAWASHIMA, and HIROSHI YAMAGUCHI, "Migration-Enhanced Epitaxy of GaAs and AlGaAs", Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 27, No. 2, 1986, pp. 169-179.
- Tomoya Shitara and Karl Eberl, "Electronic properties of InGaP grown by solid-source molecular beam epitaxy with a GaP decomposition source", Appl. Phys. Lett., Vol. 65 No. 3, 1994, pp. 356-358.
- 10. MBE Components & Accessories, Valved Arsenic Cracker Cells, RIBER, Febuary 1999.
- M. A. Herman and H. Sitter, "Molecular Beam Epitaxy : Fundamentals and Current Status", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1989, pp. 96.
- A. S. Bracker, M. J. Yang, B. R. Bennett, J. C. Culberton, W. J. Moore, Surface reconstruction phase for InAs, AISb and GaSb", Journal of Crystal Growth, vol. 220, 2000, pp. 384-392.
- B. Junno, S. Jeppesen, M.S. Miller, L. Samuelson, "A comparison of RHEED reconstruction phase on (100) InAs, GaAs and InP, Journal of Crystal Growth, vol. 164, 1996, pp. 66-70.
- F. G. Celiim Y. C. Kao, and H. Y. Liu, "In situ composition of InGaAs/InP using quadrupole mass spectrometry", J. Vac. Sci Technol., Vol. A 14, No. 6, 1996, pp.3202-3207.
- K. B. Ozanyan, P. J. Parbrook, M. Hopkinson, and C. R. Whitehouse, "In situ monitoring of the surface reconstruction on InP (100) prepared by molecular beam epitaxy", J. Appl. Phys., Vol. 82, No. 1, 1997, pp. 474-476.
- 16. GalnAsP Alloy Semiconductor, Edited by T. P. Pearsal Wiley & Sons, 1982, pp. 92.

- T. Chikyow, N. Koguchi, "Microscrystal growth of GaAs on a Se-terminated GaAlAs surface for the quantum-well box structure by sequential supplies of Ga and As moecular beams", Appl. Phys. Letters 60, 2431 (1992).
- T. Mano, K. Watanabe, S. Tsukamoto, H. Fujioka, M. Oshima, N. Koguchi, "Frabrication of InGaAs qunatum dots on GaAs(100) by droplet epitaxy", J. Crystal Growth 209, 504 (2000)
- Data in Science and Technology, Edited in Chief: R. Poershke, Semiconductor Group IV Elements and III-V Compound, Editor: O Madalung, Springer-Verlag, 1991.
- InP-Based Materials and Devices, Edited by Osamu WADA and Hideki HASEKAWA, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
- Zh. M. Wang, B.L. Liang, K.A. Sablon, and G.J. Salamo, "Nanoholes fabricated by Self-assembled gallium nanodrill on GaAs (100), Appl. Phys. Lett. 90, 113120 (2007).
- P. Boonpeng, S. Panyakeow, S. Ratanathammaphan, "Fabrication of In_{0.15}Ga_{0.85}As on GaAs by droplet molecular Beam Epitxay", J. Crystal Growth 311, 1843 (2009).

ผลงานที่ได้เผยแพร่ของงานวิจัยนี้

1. การประชุมวิชาการภายในประเทศ (Domestic Conference)

- 1.1 Poonyasiri Boonpeng, Wipakorn Jewasuwan, Pornchai Changoang, Supachok Thainoi, Somsak Panyakeow, and Somchai Ratanathammaphan, "Fabrication of In_{0.15}Ga_{0.85}As Nanohole Templates on GaAs (100)", The 32nd Electrical Engineering Conference (EECON-32), Tawaravadee Resort Hotel, Prachiburi, Thailand, 28-30 October 2009, pp. 1239-1242.
- 1.2 Poonyasiri Boonpeng, Wipakorn Jevasuwan, Pornchai Changmoang, Supachok Thainoi, Somsak Panyakeow amd Somchai Ratanathammaphan, "Fabrication of InXGa1-xGa squarelike Nanohole Template on GaAs (001) for Quantum Dot Molecules" The 33rd Electrical Engineering Conference (EECON-33), Centara Duang Tawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, 1-3 December 2010, pp. 1165-1168.

2. การประชุมวิชาการนานาชาติ (International Comference)

- 2.1 Poonyasiri Boonpeng, Wipakorn Jevasuwan, Somsak Panyakeow, Somchai Ratanathammaphan, "Fabrication of In_{0.15}Ga_{0.85}As nanohloe templates by droplet molecular beam epitaxy", International Conference on Nanoscience and Technology, China 2009, September 1-3, 2009, Beijing, China, 5P-2008, pp. 447,
- 2.2 Poonyasiri Boonpeng, Wipakorn Jevasuwan, Somsak Panyakeow, and Somchai Ratanathammaphan, "Effect of Substrate temperature on In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs (001) Nanohole Templates Grown by Droplet Molecular Beam Epitaxy", International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2009), 28 June-3 July 2009, Singapore, O-S11.12 pp. O22.
- P. Boonpeng, W. Jevasuwan, S. Panyakeow, and S. Ratanathammaphan, "Fabrication of In_{0.15}Ga_{0.85} As Nanohole Templates on GaAs (001) for Quantum Dot Molecules". 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2009), October 7-9, 2009, Miyagi, JAPAN, P-8-2, pp.66.
- 2.4 P. Boonpeng, W. Jevasuwan, S. Panyakeow, and S. Ratanathammaphan, "Transformation of Concentric Double Ring to Single Quantum Rings with Squarlike Nanoholes on GaAs (001) by Droplet Epitaxy", The 16th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2010), Berlin, Germany, 22-27 August, 2010, P1.03, pp.6.

3. วารสารวิชาการนานาชาติ (International Journal)

- 3.1 P. Boonpeng, S. Panyakeow, S. Ratanathammaphan, "Fabrication of In_{0.15}Ga_{0.85}As nanohloes on GaAs by droplet molecular beam epitaxy", Journal of Crystal Growth, Volume 311, Issue 7, 15 March 2009, Pages 1843-1846.
- 3.2 Poonyasiri BOONPENG, Wipakorn JEWASUWAN, Somsak PANYAKEOW, and Somchai RATANATHAMMAPHAN, "Fabrication of Self-Assembled InGaAs Squarelike Nanoholes on GaAs(001) by Droplet epitaxy", Japanese Journal of Applied Physics 49 (2010), 04DH9.
- 3.3 P. Boonpeng, W. Jevasuwan, N. Nuntawong, S. Thainoi, S. Panyakeow, S. Ratanathammaphan, "Transformation of concentric quantum double rings to single quantum rings with squarelike nanoholes on GaAs(0 0 1) by droplet epitaxy", *Journal of Crystal Growth, Volume 323, Issue 1,* 15 May 2011, Pages 271-274.